股票代碼:3444

利機企業股份有限公司

一一三年度年報

年報查詢網站：http://mops.twse.com.tw
公司年報網址：https://www.niching.com.tw/investors/shareholders/
中華民國一一四年五月十六日刊印

一、 **發言人、代理發言人姓名、職稱、聯絡電話及電子郵件信箱：**

發言人姓名：盧修滿	代理發言人姓名：邱智芳
職　　稱：營運支援處協理	職　　稱：財務資訊處協理
電　　話：(04)2358-8966	電　　話：(04)2358-8966
電子郵件：claire@niching.com.tw	電子郵件：chris@niching.com.tw

二、 **總公司、分公司、工廠之地址及電話：**

總公司地址：臺中市西屯區臺灣大道四段 767 號 5 樓之 5
總公司電話：(04)2358-8966
新竹營業所及工廠地址：新竹縣竹北市台元街 20 號 2 樓
新竹營業所及工廠電話：(03)611-6888
高雄營業所地址：高雄市前鎮區復興四路 12 號 6 樓-6
高雄營業所電話：(07)861-8808

三、 **股票過戶機構之名稱、地址、網址及電話：**

名稱：永豐金證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市博愛路 17 號 3 樓
網址：http://www.sinotrade.com.tw
電話：(02)2381-6288

四、 **最近年度財務報告簽證會計師姓名、事務所名稱、地址、網址及電話：**

會計師姓名：許瑞隆、蘇定堅
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
地　　址：台北市信義區松仁路 100 號 20 樓
網　　址：http://www.deloitte.com.tw
電　　話：02-27259988

五、 **海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式：**

無

六、 **公司網址：**http://www.niching.com.tw

目 錄

壹、 致股東報告書 1

貳、 公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料..... 4
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金..... 12
三、公司治理運作情形..... 16
四、簽證會計師公費資訊..... 40
五、更換會計師資訊..... 40
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業資訊..... 41
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形..... 41
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊..... 42
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比率..... 43

參、 募資情形

一、資本及股份..... 44
二、公司債辦理情形..... 45
三、特別股辦理情形..... 45
四、海外存託憑證辦理情形..... 45
五、員工認股權憑證辦理情形..... 45
六、限制員工權利新股辦理情形..... 45
七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形..... 45
八、資金運用計畫執行情形..... 45

肆、 營運概況

一、業務內容..... 46
二、市場及產銷概況..... 54
三、從業員工..... 62
四、環保支出資訊..... 63
五、勞資關係..... 63
六、資通安全管理..... 67
七、重要契約..... 69

伍、 財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況..... 71
二、財務績效..... 71
三、現金流量..... 72
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響..... 72
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫..... 73
六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項..... 73

七、其他重要事項..... 75

陸、 特別記載事項

一、關係企業相關資料..... 76
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形..... 77
三、其他必要補充事項..... 77

柒、 最近年度及截至年報刊印日止如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項..... 78

壹、 致股東報告書

一、一一三年度營業結果

（一）營業計劃實施成果　　單位:新台幣仟元

項目＼年度	113 年度	112 年度	差額	成長率
銷貨收入	1,009,564	838,853	170,711	20%
勞務收入	143,922	137,544	6,378	5%
營業收入	1,153,486	976,397	177,089	18%
營業毛利	284,926	255,756	29,170	11%
營業費用	206,633	180,477	26,156	14%
營業外收(支)	65,185	36,565	28,619	78%
稅前淨利	143,478	111,844	31,633	28%
稅後淨利	107,452	93,545	13,907	15%
每股盈餘(元)	2.39	2.12	0.27	13%

說明：

1. 綜觀 113 年度消費產品需求下降、車用需求平緩，唯獨 AI 大放異彩，利機發揮整合型材料供應商優勢，把握 AI 晶片與高階封裝需求強勁之市場變化，及中國大尺寸面板需求上升、電子標籤與車用面板發酵之機會，三大主力產品之封測相關產品營收年增 28%、驅動 IC 相關產品年增 13%、半導體載板年增 8%。整體營收及毛利金額均呈雙位數成長。
2. 營業費用主要係銷售費用增加，為強化與供應商 Simmtech 合作之深度與廣度，建置 STN 團隊將 FAE 功能移至台灣以快速回應客戶需求。整體營業費用年增 14%。
3. 營業外收入主要係加值型轉投資策略調整且中國市場回溫，轉投資收益增加，受惠美金升值外幣兌換利益也增加。整體業外收入年增 78%。
4. 綜上所述，稅後淨利年增 15%，EPS 年增 13% 達 2.39 元。
5. 113 年度稅後淨利預算達成率 64%，係 AI 以外之半導體景氣恢復及加值型轉投資貢獻未如預期。

（二）財務收支及獲利能力分析

項　　目		113 年度	112 年度
財務結構	負債占資產比率（%）	29%	24%
償債能力	流動比率（%）	235%	292%
	速動比率（%）	218%	268%
經營能力	平均收現天數（天）	158 天	183 天
	平均銷貨日數（天）	28 天	33 天
獲利能力	資產報酬率（%）	7%	7%
	股東權益報酬率（%）	10%	9%
	純益率（%）	9%	10%
	稅後每股盈餘（元）	2.39 元	2.16 元

註.平均收現天數偏高係因部分產品採價差式佣金收入模式，應收帳款遠高於勞務收入，影響計算結果。排除此部分，兩年度平均收現天數為 99 天及 110 天。

（三）研究發展狀況

研發項目	技術特色與產品應用	未來成效
奈米燒結銀膠	建立自有奈米銀及配方技術，開發適用於大尺寸晶片封裝用之低溫燒結銀，為市場上少有的特色產品。可應用於高功率元件、高速運算元件、功率放大器等高階封裝產品。	一一三年通過多家客戶認證，正進行小量試產中，並積極拓展至更多國內外客戶應用產品，以擴張市場及產品線。
高導熱銀漿	應用於 LED/半導體封裝之高散熱固晶材料。具高散熱(>30W/mK)及高接著強度，提供封裝元件滿足高壽命、高可靠度需求，應用於車用功率元件及 LED 燈等。	已獲得台灣 LED 及功率元件廠驗證通過。積極推廣導入客戶端量產，以爭取更多獲利。
客製化銀漿	以多年銀漿開發經驗為基礎，開發出異方性導電膠，並具快速固化特性，可應用於電子組件構裝。未來持續尋找新應用市場，拓展異方性導電膠產品線及應用領域，轉換成未來營運動能。	一一三年進入美系大廠供應鏈，正進行最後產品驗證中。有望持續拓張產品線及供應量。

二、一一四年營業計畫概要

（一）經營方針

以誠信為本，創新為念，建構值得信賴、實現夢想的共好企業。

（二）預期銷售數量及其依據

因產品種類多且產品組合影響銷售數量甚大，預期 114 年度產品銷售數量約為 65,057 仟 Pcs。

（三）重要之產銷政策

營運布局已統合通路代理、自有先進材料及加值型轉投資為整合型材料供應商，預期終端需求回溫、AI 晶片需求強勁且高功率及散熱市場需求暢旺，公司投入必要資源、轉型再成長。產銷政策如下：

1. 自有研發之銀漿開發策略：

燒結銀膠、導電銀漿及客製化銀漿將選擇重點客戶、集中資源深耕具有成長潛力的市場；聚焦具優勢之高散熱、高導熱及快速固化技術，開發價值型產品。

2. 均熱片拓展策略：

AI 新應用與高階封裝需求帶動散熱相關市場的成長，利機聚焦 IC 散熱解決方案，除了致力於自有產品之技術創新與突破深化散熱應用之導熱銀膠及燒結銀膠，並將持續推動併購或聯盟以掌握三大製造技術(沖壓、金屬加工、電鍍)，延伸產品線至高階市場，以成為 CoWoS 供應鏈成員為目標。

3. 載板成長策略：

STN 團隊結合銷售能力及在地技術服務，透過與三大記憶體廠的緊密客戶黏著度以及高階 SOCAMM HDI 和針對 AI Server 所開發的下世代繪圖記憶體載板(GDDR7)，並搭配與封測廠邏輯 IC 領域戰略合作協議，將提升整體營收貢獻。且藉由資源戰略部屬於邏輯 IC 領域，新產品及專案導入案件近年均有顯著成長，將持續帶動邏輯 IC 營收成長並提升比重。

4. 其他產品成長策略：

營運主力之驅動 IC 相關、封測相關、OLED 及各項新代理產品，除掌握終端需求回溫、AI 大放異彩之商機，也持續擴展電子標籤、車用面板領域及 AR/VR 應用新需求，將 114 年業績再往上推升。

三、未來公司發展策略

全球人工智慧（AI）與高效能運算（HPC）需求持續攀升，從雲端資料中心、終端裝置到特定產業類別，各個主要應用市場均面臨規格升級趨勢，半導體產業將再度迎來嶄新榮景。在 AI 持續推升高階邏輯製程晶片需求推動下，預計整體半導體市場將持續成長；半導體供應鏈包括設計、製造、封測、先進封裝等產業，在上下游縱橫合作之下，將共創新一波成長契機。公司將強化 Marketing 功能，聚焦半導體產業最新技術發展與市場需求，除了持續引進代理產品外，強化自有研發銀漿產品的技術創新與突破，趁勢乘風而起。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

川普政府新上任，全球科技廠去中化、美國退出 OECD 全球稅收協議、加重中國關稅課徵等，皆影響全球半導體供應鏈。全球主要國家積極扶植半導體產業，祭出半導體振興政策，形塑產業發展優勢，力圖提升本土產業量能和關鍵技術自主性。

對於台灣企業而言，這既是挑戰也是機遇，必須密切關注國際政經局勢變化，靈活彈性布局供應鏈，以應對潛在的風險和機遇。

董事長：張濬暉

總經理：黃道景

貳、 公司治理報告

一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

(一)董事

1. 董事

114 年 4 月 14 日

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事長	中華民國	張濬暉	男 71~80 歲	111.6.15	3	88.3.15	1,040,081	2.66%	1,234,872	2.74%	48,193	0.11%	0	0%	私立輔仁大學法律系 慶謙建設(股)公司董事長 利機企業（股）公司監察人 利機企業（股）公司副董事長	本公司董事長 日出彤紅投資(股)公司董事長 利機貿易(蘇州)有限公司董事 永佶企業有限公司董事長	董事	張宏基	兄弟	-
副董事長	中華民國	張惟森	男 31~40 歲	111.6.15	3	108.6.25	434,000	1.11%	487,949	1.08%	0	0%	0	0%	Hotel Institute Montreux, Postgraduate Diploma, Hospitality Business Management Wynn Palace,F&B,Server 亞都麗緻,巴黎廳,領班	本公司副董事長	無	無	無	-
董事	中華民國	張宏基	男 61~70 歲	111.6.15	3	82.5.7	1,516,794	3.88%	1,834,866	4.08%	777,164	1.73%	0	0%	New Jersey Institute of Technology,工業工程系碩士 拓凱實業(股)公司高爾夫事業部經理 台灣高技(股)公司業務部協理 APET Co.,Ltd.董事 利機企業（股）公司總經理 利騰國際科技(股)公司董事	本公司執行長 利機貿易(蘇州)有限公司董事長 Advanced Corporation 董事 聚泰投資(股)公司董事長 群康生技(股)公司董事 東昇應材(股)公司董事 聚祥投資(股)公司董事長 信泰利機(蘇州)貿易有限公司董事長 STNC Hong Kong Holdings Limited 董事	董事長	張濬暉	兄弟	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
董事	韓國	Simmtech Holdings Co.,Ltd	-	111.6.15	3	96.6.28	1,738,408	4.44%	1,954,506	4.34%	0	0%	0	0%	-	-	無	無	無	-
		代表人：李京洙	男 61~70歲				0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	Yeonsei University, Graduate School Seoul, KOREA Sociology HANIL TOYO CO., LTD. / Procurement Dept.Assistant Manager MULTIPACK CO.,LTD./Sales Dept. Manger SIMMTECH CO., LTD./ Finance Division Director Director of Simmtech Holdings CO.,LTD. Director of Simmtech Hong Kong Holdings Limited. Director of Simmtech Japan Incorporation Director of STJ Holdings CO.,LTD. Director of T.E.TECH(M) SDN.BHD. Supervisor of Simmtech Graphics CO.,LTD. Supervisor of Simmtech Niching(Suzhou) CO.,LTD. Supervisor of Simmtech Electronics(Xian) CO.,LTD.	SIMMTECH HOLDINGS CO., LTD./ Finance Division Director	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	張嘉興	男 51~60歲	111.6.15	3	96.6.28	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	國立政治大學財稅系 國立交通大學 EMBA 中國信託商業銀行授信專員 大華證券(股)公司承銷部副理 元富證券(股)公司承銷部經理 輔祥實業(股)公司董事長室/經營管理室高級專員 世界中心科技(股)公司執行董事/財務長	先益電子工業(股)公司獨立董事 明係事業(股)公司獨立董事 同行致遠管理顧問有限公司負責人 鼎誠投資(股)公司負責人 宇辰系統科技股份有限公司獨立董事	無	無	無	-

職稱	國籍或註冊地	姓名	性別年齡	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數		配偶、未成年子女現在持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任本公司及其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人			備註
							股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
獨立董事	中華民國	施明宗	男 51~60歲	111.6.15	3	105.6.21	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	政大會計研究所碩士 高考會計師及格 勤業會計師事務所經理 東海大學會計系兼任講師 金億豐實業(股)公司財務部協理 橋椿金屬(股)公司財務部經理、執行長特助 台灣百和工業(股)公司財務部協理、董事長特助、總經理室副總 三合興股份有限公司董事長	印尼百和(股)公司董事 百和國際有限公司董事長特助	無	無	無	-
獨立董事	中華民國	蔡篤銘	男 61~70歲	111.6.15	3	96.6.28 註2	0	0%	0	0%	3,581	0.01%	0	0%	私立東海大學工業工程學士 美國愛荷華州立大學工業工程碩士 美國愛荷華州立大學工業工程博士 瑞士商迪吉多電腦股份有限公司(Digital Equipment Corp.,Principal Engineer) 私立元智大學工業工程與管理系教授	本公司獨立董事	無	無	無	-

註1：董事長與總經理或相當職務者（最高經理人）為同一人、互為配偶或一親等親屬者：無。

註2：於96.6.28此屆當選後卸任，於111.6.15此屆再次當選。

2.法人股東之主要股東

113 年 12 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	
Simmtech Holdings Co.,Ltd.	Chun Se Ho	39.9%
	LIGHTMAC PTE.LTD	15.8%
	Simmtech Holdings co.,ltd.	4.1%
	Song Chan Young	1.5%
	Kim Tae-sul	1.3%
	Hyun Seung-won	1.3%
	Lim Sung Hyuk	1.2%
	Others	34.9%
	Total	100.0%

3.主要股東為法人者其主要股東：

113 年 12 月 31 日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	
LIGHTMAC PTE.LTD	CHUN SE HO	57.0%
	PARK EUNKYUNG	2.1%
	CHUN JEFFERY E	25.7%
	CHUN MICHELLE EUN	8.5%
	聚祥投資股份有限公司	6.7%
	Total	100.0%

法人股東名稱	法人股東之主要股東	
聚祥投資股份有限公司	張宏基	65%
	張廷宇	10%
	張韶恩	10%
	劉雅麗	15%
	Total	100.0%

4.董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露

條件 / 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事 張濬暉	● 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ● 日出彤紅投資(股)公司董事長、利機貿易(蘇州)有限公司董事、永佶企業有限公司董事長。	(1) 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人。 (2) 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之	0
董事 張惟森	● 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ● 現任本公司副董事長。		0

條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司獨立董事家數
董事 張宏基	● 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ● 現任本公司執行長、利機貿易(蘇州)有限公司董事長、聚泰投資(股)公司董事長、群康生技(股)公司董事、東昇應材(股)公司董事、Advanced Corporation 董事、聚祥投資(股)公司董事長、信泰利機(蘇州)貿易有限公司董事長、STNC Hong Kong Holdings Limited 董事。	董事(理事)、監察人(監事)或受僱人。 (3) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股5%以上股東。 (4) 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。 (5) 未有公司法第 30 條各款情事之一。	0
董事 Simmtech Holdings Co.,Ltd 代表人： 李京洙	● 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ● 現任 SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD./ Finance Division Director		0
獨立董事 張嘉興	● 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ● 現任先益電子工業(股)公司獨立董事、明係事業(股)公司獨立董事、同行致遠管理顧問有限公司負責人、鼎誠投資(股)公司負責人、宇辰系統科技股份有限公司獨立董事。	(1)非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)非公司或其關係企業之董事、監察人 (3)非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。 (4)非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)非直接持有公司已發行股份總數 5%以上、持股前五名或依公司法第 27 條第 1 項或第 2 項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人。 (6)非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人 (7)非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監 事)或受僱人。 (8)非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股 5%以上股東。 (9)非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣 50 萬元之商務、法務、財務、 會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。。 (10)未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (11)未有公司法第 30 條各款情事之一。 (12)未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。	3
獨立董事 施明宗	● 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ● 現任印尼百和(股)公司董事、百和國際有限公司董事長特助。		0
獨立董事 蔡篤銘	● 具商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗。 ● 現任本公司董事。		0

5.董事會多元化及獨立性

(1)董事會多元化政策、目標及達成情形

多元化政策：

本公司董事會成員組成多元化政策訂定於「公司治理實務守則」，內容如下：

本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定五人以上之適當董事席次。

董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次三分之一。

2、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1、營運判斷能力。

2、會計及財務分析能力。

3、經營管理能力。

4、危機處理能力。

5、產業知識。

6、國際市場觀。

7、領導能力。

8、決策能力。

多元化政策之具體管理目標及達成情形:

管理目標	達成情形
增加一席女性董事	未達成 下屆全面改選時選任
獨立董事未連續連任	未達成 下屆全面改選時選任
適足多元之專業知識與技能(加強財務會計和風險管理專業)	未達成 下屆全面改選時選任
獨立董事席次逾董事席次三分之一	達成
兼任經理人之董事不逾董事席次1/3	達成

董事會成員多元化政策落實情形如下：

本公司設有7席董事，其中獨立董事為3席，具員工身份之董事占比為14%，外籍董事占比為14%，獨立董事占比為43%；3位獨立董事任期年資分別為1年、6年及15年；1位董事年齡在70歲以上，3位董事年齡在60-70歲，2位在50-60歲，1位在40歲以下；均在各領域有不同專長，長於領導、決策、營運判斷、經營管理、會計及財務分析、危機處理且具有產業知識及國際市場觀者有張濬暉、張宏基董事。Simmtech係韓國上市公司其代表人為財務長，具備營運判斷、會計及財務分析、危機處理、產業知識及國際市場觀。獨立董事張嘉興曾任職銀行、證券、相關產業高階主管且完成中國設廠案，目前經營顧問公司因此具備前述各項專長。獨立董事施明宗具備會計師、大學講師及董事長特助、印尼公司董事等資歷，熟稔營運判斷、會計及財務分析、經

營管理及國際市場觀。獨立董事蔡篤銘任職大學教授，有豐富的研究經驗和專業技能，能夠有效地傳達複雜的概念和思想，推動企業創新發展。

多元化核心 董事姓名		基本組成								產業經驗及專業能力						
		國籍	性別	兼任本公司員工	年齡				獨立董事任期年資(3年以下)	會計及財務分析	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導	決策
					50以下	51至60	61至70	71~								
董事	張濬暉	台灣	男					V		V	V	V	V	V	V	V
	張惟森	台灣	男		V							V		V		
	張宏基	台灣	男	V			V			V	V	V	V	V	V	V
	Simmtech Holdings 代表人李京洙	韓國	男				V			V	V	V	V	V		
獨立董事	張嘉興	台灣	男			V				V	V	V	V	V	V	V
	施明宗	台灣	男			V				V	V			V		
	蔡篤銘	台灣	男				V		V				V	V		

(2)董事會獨立性

本公司董事計 7 席，其中獨立董事為 3 席，佔比為 43%。獨立董事之資格及選任，皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」之規定，並依據「上市上櫃公司治理實務守則」規定辦理。且各董事及獨立董事間無證券交易法第 26 條之 3 第 3 項及第 4 項規定之情事。

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管

114 年 4 月 14 日

職稱	國籍	姓名	性別	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要經（學）歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人			備註
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係	
執行長	中華民國	張宏基	男	82.4.15	1,834,866	4.08%	777,164	1.73%	0	0%	New Jersey Institute of Technology,工業工程系碩士 拓凱實業(股)公司高爾夫事業部經理 台灣高技(股)公司業務部協理 APET Co.,Ltd.董事 利騰國際科技(股)公司董事 本公司總經理	本公司執行長 利機貿易(蘇州)有限公司董事長 Advanced Corporation 董事 信泰利機(蘇州)貿易有限公司董事長 STNC Hong Kong Holdings Limited 董事 聚泰投資(股)公司董事長 聚祥投資(股)公司董事長 群康生技(股)公司董事 東昇應材(股)公司董事	-	-	-	-
總經理	中華民國	黃道景	男	84.3.9	61,142	0.14%	0	0%	0	0%	私立文化大學化學系 台灣高技(股)公司業務課長 本公司通路事業部資深副總經理 利騰國際科技(股)公司董事	本公司總經理 利機貿易(蘇州)有限公司董事兼總經理	-	-	-	-
資深副總經理	中華民國	池佳龍	男	113.7.4	0	0%	0	0%	0	0%	私立元智大學製造工程與管理系 國立交通大學 EMBA 力成科技股份有限公司處長 景碩科技股份有限公司資深處長	無	-	-	-	-
副總經理	中華民國	沈宇謙	男	100.4.1	164,492	0.37%	0	0%	0	0%	私立樹德工業專科學校工業工程科 國立中山大學管理學院 EMBA 育豪實業(股)公司業務課長 昆暘實業(股)公司業務經理	無	-	-	-	-
財務資訊處協理	中華民國	邱智芳	女	90.5.1	40,000	0.09%	0	0%	0	0%	私立東海大學會計系 國立交通大學 EMBA 建智聯合會計師事務所資深領組 鉅唐實業(股)公司會計課長	利機貿易(蘇州)有限公司監察人 信泰台灣實業股份有限公司董事長	-	-	-	-
營運支援處協理	中華民國	盧修滿	女	92.7.1	7,660	0.02%	0	0%	0	0%	私立東海大學社會系 三采建設(股)公司行政部副理 力毅電子(股)公司行政部副理	無	-	-	-	-
公司治理主管	中華民國	陳賢玲	女	109.4.1	34,105	0.08%	0	0%	0	0%	私立逢甲大學國貿系 利騰國際科技(股)公司主辦會計	無	-	-	-	-

二、最近年度給付董事、總經理及副總經理等之酬金

(一)董事之酬金：

113年12月31日；單位:新台幣仟元

職稱		姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例		兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
			報酬(A)		退職退休金(B)		董事酬勞(C)		業務執行費用(D)				薪資、獎金及特支費等(E)		退職退休金(F)		員工酬勞(G)						
																	本公司		財務報告內所有公司				
			本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	現金金額	股票金額	現金金額	股票金額	本公司	財務報告內所有公司	
一般董事	董事長	張濬暉	3,120	3,120	0	0	1,894	1,894	0	0	5,014 4.67%	5,014 4.67%	6,990	6,990	52	52	892	0	892	0	12,948 12.05%	12,948 12.05%	0
	董事	張惟森																					
	董事	張宏基																					
	董事	Simmtech Holdings 代表人: 李京洙																					
獨立董事	獨立董事	張嘉興	900	900	0	0	1,420	1,420	0	0	2,320 2.16%	2,320 2.16%	0	0	0	0	0	0	0	0	2,320 2.16%	2,320 2.16%	0
	獨立董事	施明宗																					
	獨立董事	蔡篤銘																					

1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性：

本公司獨立董事之職責相關事項，依本公司「公司章程」及「獨立董事之職責範疇規則」辦法規定，本公司董事執行本公司職務時，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值於不超過同業通常水準支給議定。如公司有盈餘時，應提撥不高於百分之三為董監事酬勞，得參酌董事評比之得分比例增減調整。

2.除上表揭露外，最近年度公司董事提供服務(如擔任母公司/財務報告內所有公司/轉投資事業非屬員工之顧問等)領取之酬金：無。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名			
	前四項酬金總額(A+B+C+D)		前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	
	本公司	財務報告內所有公司 H	本公司	財務報告內所有公司 I
低於 1,000,000 元	一般董事：張宏基、Simmtech Holdings 代表人李京洙 獨立董事：蔡篤銘、張嘉興、施明宗	一般董事：張宏基、Simmtech Holdings 代表人李京洙 獨立董事：蔡篤銘、張嘉興、施明宗	一般董事：Simmtech Holdings 代表人李京洙 獨立董事：蔡篤銘、張嘉興、施明宗	一般董事：Simmtech Holdings 代表人李京洙 獨立董事：蔡篤銘、張嘉興、施明宗
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	一般董事：張惟森	一般董事：張惟森	一般董事：張惟森	一般董事：張惟森
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	一般董事：張濬暉	一般董事：張濬暉	一般董事：張濬暉	一般董事：張濬暉
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	－	－	－	－
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	－	－	一般董事：張宏基	一般董事：張宏基
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	－	－	－	－
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	－	－	－	－
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	－	－	－	－
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	－	－	－	－
100,000,000 元以上	－	－	－	－
總計	7 人	7 人	7 人	7 人

(二)總經理及副總經理之酬金

113 年 12 月 31 日；單位：新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等等(C)		員工酬勞金額(D)				A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例（%）		領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
執行長	張宏基	12,708	13,657	400	400	11,800	11,800	2,395	0	2,395	0	27,303 25.41%	28,252 26.29%	0
總經理	黃道景													
資深副總經理	池佳龍													
資深副總經理	夏華興													
副總經理	沈宇謙													

酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	財務報告內所有公司E
低於1,000,000 元	—	—
1,000,000 元（含）～2,000,000 元（不含）	—	—
2,000,000 元（含）～3,500,000 元（不含）	夏華興	夏華興
3,500,000 元（含）～5,000,000 元（不含）	沈宇謙、池佳龍	沈宇謙、池佳龍
5,000,000 元（含）～10,000,000 元（不含）	張宏基、黃道景	張宏基、黃道景
10,000,000 元（含）～15,000,000 元（不含）	—	—
15,000,000 元（含）～30,000,000 元（不含）	—	—
30,000,000 元（含）～50,000,000 元（不含）	—	—
50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含）	—	—
100,000,000 元以上	—	—
總計	5 人	5 人

(三)分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

113 年 12 月 31 日;單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額占稅後純益之比例（%）
經理人	執行長	張宏基	0	3,713	3,713	3.46%
	總經理	黃道景				
	副總經理	沈宇謙				
	資深副總經理	池佳龍				
	資深協理	蘇志昌				
	協理	邱智芳				
	協理	盧修滿				
	經理	陳賢玲				

(四)本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

1.最近二年度董事、監察人、總經理及副總經理酬勞金額分析：

單位：新台幣仟元

項 目		112 年度	113 年度
本公司	酬金總額	25,337	34,637
	占稅後純益比例	27.09%	32.24%
合併報表所有公司	酬金總額	28,070	35,586
	占稅後純益比例	30%	33.12%

2.給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

(1)本公司董事酬金係依據公司章程第 30 條及第 31 條之規定，不論公司營業盈虧，公司得支給報酬，其報酬授權董事會依其對公司營運參與程度及貢獻之價值於不超過同業通常水準支給議定。年度如有獲利，應提撥不高於百分之三為董監事酬勞。另依據薪資報酬委員會組織規程之規定，參考同業通常水準支給情形，並考量個人績效評估結果、所投入之時間、所擔負之職責、達成個人目標情形、擔任其他職位表現、公司近年給予同等職位者之薪資報酬，暨由公司短期及長期業務目標之達成、公司財務狀況等評估個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

董事薪酬與績效評估結果之關聯性與合理性如下:

1)依董事會績效評估辦法，績效評估之衡量項目含括六大面向：公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制。個別董事依衡量項目自評，平均得分介於 3.87~4.96 分/滿分 5 分，整體而言運作情形優良。

2)董事報酬(每月)，包含兩部分：

基本報酬：檢視個別董事績效評估結果，除了韓籍董事因語言、法令及距離因素得分較低，其他董事得分差異不大，因此每月基本報酬原則上均相同。

報酬加給：特殊職務之董事，評估其所擔負之職責與法律責任，以及投入時間之差異性，依職務分別給予額外之報酬加給。

3)董事酬勞(年度)：同基本報酬，原則上依任期天數平均分配。

(2)本公司總經理及副總經理之酬金包括職位薪資及績效薪酬等。本公司經理人給付之政策如下：

薪酬項目		辦法依據	計算方式	計算參數
職位薪酬		職等職稱核薪標準表	依照經理人到職時在公司內部擔任之職務及職等，參酌「職等職稱核薪標準表」以及市場薪資水準核敘每月固薪	1.核薪標準表 2.所參照職類 3.市場行情
績效薪酬	員工酬勞	員工酬勞管理辦法	1.公司獲利分派百分之三(含)以下的員工酬勞之分配方式： 員工酬勞＝ 基本分配(65%) +創利分配(10%) +經營分配(15%) + 執行長特別分配(5%) + 董事長特別分配(5%)	1.基本分配：考核、年資、職務、職等 2.創利分配：依部門創利金額 3.經營分配：依職等、職務、創利金額 4.特別分配：特別獎勵具優異貢獻者
			2.公司獲利分派百分之三以上的員工酬勞之分配方式： 各部門主管提報當年度表現傑出且未來具有發展潛力之人員，由董事長與執行長依表現核定之	1.年度考核 2.創利值 3.年度實質特殊貢獻
	年度績效獎金	1.董事暨經理人薪酬管理辦法 2.(一般人員)績效獎金管理辦法	年度績效獎金＝個人月總薪(不含伙食費)×(當年度該部門平均績效獎金月數 + 一級主管 Extra 月數 + 執行長調整月數 + 董事長調整月數)	1.當年度該部門平均績效獎金月數：依(一般人員)績效獎金管理辦法計算 2.一級主管 Extra 月數：依全年稅前每股淨利及職務別，參照對照表。 3.特別調整：董事長及執行長得依照各經理人該年度績效表現於上限內調整(加或減)
	年終獎金	董事暨經理人薪酬管理辦法	發放標準為月薪(扣除伙食費)之二個月	1.於公司每股稅前盈餘為正時 2.經理人無重大缺失
	其他薪酬	無	因特殊經營績效產生之績效獎酬，經提薪酬委員會評估，報准董事會實施	簽呈核准

(3)經理人酬金包含薪資及獎金，給付政策如上表。本公司經理人績效評估標準、年度及長期之績效目標，與薪資報酬之政策、制度、標準與結構如下：

1)本公司經理人績效評估標準：本公司設有績效考核制度，每半年評核績效乙次，各經理人應於每期期初設立考核目標，並於期末自評當期表現後，將考核表送交總經理以上主管評核。考核內容應包括營運績效、管理表現及未來職能發展等。

2)年度及長期之績效目標：每年配合公司之營運方針，經理人將相關項目之列入年度重要考核項目。

(4)給付酬金之程序：悉依本公司薪資報酬委員會組織規程辦理，職位薪酬於每年第一次薪資報酬委員會定期檢討其合理性及市場競爭力，績效薪酬則於發放前由薪資報酬委員會審核通過發放。

(5)給付酬金與經營績效及未來風險之關聯性：以歷年實付酬金分析，績效薪酬約佔其酬金總額 35%~45%，與經營績效具有高度關聯性，並每年比對諮鼎管理顧問公司所提供之薪資調查，本公司總經理及副總經理之薪資落點並無特異，尚屬合理低風險。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形

113 年度董事會開會 6 次，董事出列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數（B）	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註(A)
董事長	張濬暉	6	0	100%	111.6.15 全面改選連任應出席 6 次
董事	張惟森	6	0	100%	111.6.15 全面改選新任應出席 4 次
董事	張宏基	6	0	100%	111.6.15 全面改選連任應出席 6 次
董事	Simmtech Holdings 代表人: 李京洙	1	5	17%	111.6.15 全面改選連任應出席 6 次
獨立董事	張嘉興	6	0	100%	111.6.15 全面改選連任應出席 6 次
獨立董事	施明宗	6	0	100%	111.6.15 全面改選連任應出席 6 次
獨立董事	蔡篤銘	6	0	100%	111.6.15 全面改選新任應出席 6 次

其他應記載事項：

一、董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：已設置審計委員會，故不適用。

(二)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形。

董事會 日期/期別	議案內容	利益迴避董事	利益迴避 原因	參與表決情形
113.03.07 第十六屆 第 11 次	1.一一二年度董事酬勞暨經理人員工酬勞分配案。 2.一一三年度董事暨經理人薪酬結構及給付金額。	1.全體董事 2.全體董事	因與其自身有利害關係	個別離席迴避行使表決權
113.12.26 第十六屆 第 16 次	1.一一三年度經理人年終獎酬案。	董事張宏基	因與其自身有利害關係	本公司董事張宏基兼任經理人，不得加入討論及表決並予以迴避

三、董事會自我評鑑之評估週期及期間、評估範圍、方式及評估內容等資訊，並填列董事會評鑑執行情形：

評估週期	每年執行一次	評估期間	113.01.01~113.12.31
性質	評估範圍	評估方式	評估內容
個別董事	個別董事成員	個別董事成員自評	公司目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制
董事會	董事會	董事會內部自評	對公司營運之參與程度、提升董事會決策品質、董事會組成與結構、董事的選任及持續進修、內部控制
審計委員會	審計委員會及個別審計委員	審計委員會內部自評及審計委員會成員自評	對公司營運之參與程度、審計委員會職責認知、提升審計委員會決策品質、審計委員會組成及成員選任、內部控制
薪資報酬委員會	薪資報酬委員會及個別薪資報酬委員	薪資報酬委員會內部自評及薪資報酬委員自評	對公司營運之參與程度、薪酬委員會職責認知、提升薪酬委員會決策品質、薪酬委員會組成及成員選任
風險管理委員會	風險管理委員會及個別風險管理委員	風險管理委員會內部自評及風險管理委員自評	對公司營運之參與程度、風險管理委員會職責認知、提升風險管理委員會決策品質、風險管理委員會組成及成員選任

評估結果：

整體來說，董事會及各功能性委員會運作情形優良，依「董事會績效評估辦法」規定，本公司董事會績效評估結果應作為遴選或提名董事時之參考依據；並將個別董事績效評估結果作為訂定其個別薪資報酬之參考依據。前開董事會績效評估結果將提交114年3月13日薪資報酬委員會，並提報114年3月13日董事會，作為檢討及改進之依據。

各項評估結果如下：(1代表極差、2代表差、3代表普通、4代表優、5代表極優)

■ 個別董事成員績效評估

評量項目 23 項指標中，各構面平均分數為 4.77 分/總分 5 分。

評估項目	題數	平均得分
A. 公司目標與任務之掌握	3	5.00
B. 董事職責認知	3	4.90
C. 對公司營運之參與程度	8	4.61
D. 內部關係經營與溝通	3	4.48
E. 董事之專業及持續進修	3	4.90
F. 內部控制	3	5.00
合計/平均分數	23	4.77

■ 董事會績效評估

評量項目 45 項指標中，各構面平均分數為 4.90 分/總分 5 分。

評估項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	12	4.80
B. 提升董事會決策品質	12	4.92
C. 董事會組成與結構	7	4.96
D. 董事之選任及持續進修	7	4.92
E. 內部控制	7	5.00
合計/平均分數	45	4.90

■ 審計委員會

評量項目 21 項指標中，各構面平均分數為 4.98 分/總分 5 分。

評估項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	4.92
B. 功能性委員會職責認知	4	5.00
C. 提升功能性委員會決策品質	7	5.00
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	5.00
E. 內部控制	3	5.00
合計/平均分數	21	4.98

■ 薪資報酬委員會

評量項目 18 項指標中，各構面平均分數為 4.98 分/總分 5 分。

評估項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	4.92
B. 功能性委員會職責認知	4	5.00
C. 提升功能性委員會決策品質	7	5.00
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	5.00
合計/平均分數	18	4.98

■ 風險管理委員會

評量項目 18 項指標中，各構面平均分數為 4.87 分/總分 5 分。

評估項目	題數	平均得分
A. 對公司營運之參與程度	4	4.75
B. 功能性委員會職責認知	4	4.75
C. 提升功能性委員會決策品質	7	5.00
D. 功能性委員會組成及成員選任	3	4.89
合計/平均分數	18	4.87

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標（例如設立審計委員會、提昇資訊透明度等）與執行情形評估：第十一屆上市櫃公司治理評鑑，本公司列於上櫃公司排名級距 21%~35%。

（二）審計委員會運作情形：

一一三年度審計委員會開會 6 次（A），列席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數（B）	委託出席次數	實際出席率(%)【B/A】	備註
獨立董事	張嘉興	6	0	100%	
獨立董事	施明宗	6	0	100%	
獨立董事	蔡篤銘	6	0	100%	

其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(一)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

審計委員會日期/期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.03.07 第一屆 第十次	1.內部稽核主管之內部稽核報告。 2.一一二年度員工及董事酬勞分派案。 3.一一二年度營業報告書及財務報表案。 4.一一二年度盈餘分配案。 5.一一二年度盈餘轉增資發行新股案。 6.通過一一二年度公司內部控制制度聲明書。 7.本公司一一三年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 8.購置企業營運總部案。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提交董事會討論。	不適用
113.05.10 第一屆 第十一次	1.內部稽核主管之內部稽核報告。 2.一一三年第一季合併財務報表。 3.經濟部申請登記之公司印鑑章之專責保管人員案。		
113.07.04 第一屆 第十二次	1.訂定一一二年度盈餘分配案之除息、除權基準日及其相關事宜。 2.投資明鈞源精微科技股份有限公司。		

審計委員會日期/期別	議案內容	審計委員會決議結果	公司對審計委員會意見之處理
113.08.07 第一屆 第十三次	1.內部稽核主管之內部稽核報告。 2.一一三年第二季合併財務報表。	本案經主席徵詢全體出席委員無異議照案通過，提交董事會討論。	不適用
113.11.06 第一屆 第十四次	1.內部稽核主管之內部稽核報告。 2.更換簽證會計師案並重新評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。 3.一一三年第三季合併財務報表。 4.訂定一一四年度稽核計劃。 5.修訂本公司【審計委員會組織規程】部分條文案。 6.修訂本公司【風險管理辦法】案。		
113.12.26 第一屆 第十五次	1.一一四年度預算案。 2.一一四年度融資銀行及融資額度案。 3.處分轉投資利騰國際科技股份有限公司案。 4.修訂【內部控制制度】及【內部稽核制度】案。		

(二)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（應包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）。

1.本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員進行稽核業務報告，與委員溝通稽核報告結果及其追蹤報告執行情形，並針對委員的疑問進行討論溝通；本公司獨立董事與內部稽核主管溝通狀況良好。

2.本公司簽證會計師不定期針對財務報表查核或核閱結果、重大事項以及其他相關法令更新或要求之事項進行溝通；本公司獨立董事與簽證會計師溝通狀況良好。

3.本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形，請參閱本公司網站。

(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？	V		本公司訂定公司治理實務守則，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站中。	無重大差異
二、公司股權結構及股東權益 （一）公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛	V		(一) 本公司已設置發言人、代理發言人及股務等單位專人處理對外資訊發表、股東建議或糾紛等問題。 (二) 本公司委由股務代理機構定期更新股東名冊及主要股東名冊，充分掌握控制公	無重大差異

<table>
<tr><th rowspan="2">評估項目</th><th colspan="3">運作情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td>及訴訟事宜，並依程序實施？
（二）公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？
（三）公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制？
（四）公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？</td><td>V
V
V</td><td></td><td>司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。
(三) 本公司已訂有「子公司監督及管理辦法」及「關係人相互間財務業務相關作業規範」已規範相關事宜並遵循之，且各子公司皆依內控制度及辦法執行各項日常作業，並由稽核單位、財務部門及委由會計師定期進行查核，個人電腦進出內部網路及防火牆管制皆依內控「電子資料處理循環」執行。
(四) 本公司訂定「內部重大資訊處理作業程序」，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。本公司於新任董事/內部人就/解任及於寄發董事會開會通知時，一併提供證券市場相關規範等宣導手冊；每季定期對董事所有員工進行防範內線交易之教育宣導。</td><td>無重大差異</td></tr>
<tr><td>三、董事會之組成及職責
（一）董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？
（二）公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？
（三）公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？
（四）公司是否定期評估簽證會計師獨立性？</td><td>V
V
V
V</td><td></td><td>(一) 請詳本年報第 9 頁說明。
(二) 本公司於111年8月2日設置風險管理委員會。
(三) 評估結果已提報114年3月13日董事會，用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。
(四)1.本公司每年(一年一次)參考審計品質指標(AQIs)定期評估簽證會計師獨立性及適任性，並提報董事會評估通過。評估機制如下：
取得簽證會計師提供之「審計品質指標(AQIs) 」及其出具之「獨立性聲明書」，並參酌會計師法第47條、審計品質指標(AQI)及中華民國會計師職業道德規範公報第10號「正直、公正客觀及獨立性」制定審酌會計師獨立性及適任性之評估項目，評估項目如下：
<table>
<tr><th>評估項目</th><th>評估結果</th></tr>
<tr><td>1.簽證會計師與本公司未有直接或重大間財務利益關係。</td><td>■是
□否</td></tr>
<tr><td>2.簽證會計師與本公司未有重大密切之商業關係司。</td><td>■是
□否</td></tr>
<tr><td>3.簽證會計師於審計本公司時未有潛在之僱佣關係。</td><td>■是
□否</td></tr>
<tr><td>4.簽證會計師未有與本公司有金錢借貸之情事。</td><td>■是
□否</td></tr>
</table></td><td>無重大差異</td></tr>
</table>

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			5.簽證會計師未收受本公司及本公司董事、經理人價值重大之餽贈或禮物(其價值為超越一般社交禮儀標準）。 ■是 □否 6.簽證會計師並無已連續七年提供本公司審計服務。 ■是 □否 7.簽證會計師未握有本公司之股份。 ■是 □否 8.簽證會計師本人、其配偶或受扶養親屬、其審計小組於審計期間或最近兩年內未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務，亦確定於未來審計期間不會擔任前述相關職務。 ■是 □否 9.會計師應使其助理人員確守誠實、公正及獨立性。 ■是 □否 10.截至目前為止，未受有處分或損及獨立原則之情事。 ■是 □否 11.未兼營可能喪失其獨立性之其他事業。 ■是 □否 12.簽證會計師是否已符合會計師職業道德規範公報第10號有關獨立性之規範，並取得簽證會計師出具之「獨立性聲明書」 ■是 □否 13.經審視簽證會計師事務所之審計品質指標(AQI)，各構面皆未發現有重大影響審計品質之情事。 ■是 □否 2.經評估勤業眾信聯合會計師事務所許瑞隆及蘇定堅會計師均符合獨立性及適任性評估標準，足堪擔任本公司簽證會計師。最近一次評估經114年3月13日審計委員會決議通過後，並提請114年3月13日董事會決議通過。 3.另因應國際會計師職業道德委員會(IESBA)，其發布之國際專業會計師職業道德準則（IESBA Code）規定之修正，審計委員會應預先核准財務報表簽證會計師事務所及其全球聯盟會員所（以下統稱為“簽證會計師”）提供的所有非確信服務。114年3月13日	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			審計委員會已同意此類服務不會造成自我評估威脅，且其他獨立性威脅已降至可接受水準。	
四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、協助董事、監察人遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？	V		本公司經109年3月26日董事會決議通過，依「上櫃公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之規定，指派財務部陳賢玲經理擔任公司治理主管，其從事公開發行公司財務及管理等相關工作經驗達3年以上，依法令規定年度持續進修。主要職責如下： 1.依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。 2.辦理公司登記及變更登記。 3.製作董事會及股東會議事錄等。 4.協助推行並強化公司治理。 5.提供董事執行業務所需資料。 6.協助董事就任、遵循法令及持續進修。 7.其他法令規定之相關事宜。	無重大差異
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？	V		(一)本公司為加強與利害關係人之溝通，除於公司網站標示聯絡窗口與方式作投資股東與消費客戶的溝通管道外，主動向媒體與投信法人說明公司營運狀況；負責投資人關係之專人，有發生股東建議、詢問事項及回覆狀況，會對董事長、副董事長及總經理進行報告。 (二)本公司定期拜訪主要客戶瞭解產品問題與未來需求。 (三)公司內部每月舉辦主管溝通會議，強化同仁溝通管道。 (四)目前各項資訊均放置公司網站各區，並於公司網站建置利害關係人專區。	無重大差異
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？	V		本公司委任永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理各項股務事宜。	無重大差異
七、資訊公開 (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？	V		(一)本公司已設置網站(www.niching.com.tw)，揭露財務業務及公司治理資訊。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
（二）公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ （三）公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？	V V		(二)本公司指定專人負責公司資訊之蒐集與揭露，並落實發言人制度，另於本公司網站揭露法人說明會簡報。 (三)本公司歷年年度財務報告、第一、二、三季財務報告及各月份營運情形均於規定期限前提早公告。	無重大差異
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情等）？	V		本公司已依規定定及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務及業務資訊，並設有公司網站，供股東及社會大眾等參考。	無重大差異
九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施? 公司治理中心公布第十一屆上市櫃公司治理評鑑，本公司獲得上櫃公司21%~35%級距，可見在落實公司治理上之努力已有一定成績，將依評鑑結果及新一年度之評鑑項目進行檢討與擬訂可行之改善方案。				

(四)薪資報酬委員會組成、職責及運作情形

1.薪資報酬委員會成員資料

身分別	條件 姓名	專業資格與經驗	獨立性情形	兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數
獨立董事(召集人)	張嘉興	參閱第8頁董事資料相關內容	參閱第8頁董事資料相關內容	3
獨立董事	施明宗			0
獨立董事	蔡篤銘			0

2.薪資報酬委員會運作情形資訊

本公司薪資報酬委員會委員計3人，任期為111年6月15日至114年6月14日。113年度開會3次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%)(B/A)	備註
召集人	張嘉興	3	0	100%	111.6.15連任
委員	施明宗	3	0	100%	111.6.15連任
委員	蔡篤銘	3	0	100%	111.6.15連任

其他應記載事項：

1.董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因)：無此情形。

2.薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無此情形。

(五)推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？	V		1.本公司由經營團隊組成永續發展推動小組，負責本公司永續運營政策、制度及管理方針之訂定與檢討及跨部門溝通。 2.永續發展推動小組總召集人由總經理擔任，財務資訊處協理擔任執行秘書，與業務、行政、廠務、財務、資訊等單位，依環境保護E、社會責任S、與公司治理G等功能組織及推行實務編成各項工作小組。 3.預計今年下半年於董事會下設置永續發展委員會，由董事會檢視相關執行工作內容與目標改善進度，提供建議與方向予推動小組進行調整。	無重大差異

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td>二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？</td><td>V</td><td></td><td>本公司永續發展推動小組持續與利害關係人互動及溝通以建立永續議題之回應機制，依循AA1000 利害關係人議合標準的五大原則進行利害關係人鑑別，並以GRI 準則所列各考量面為蒐集永續議題基礎，依循GRI 重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略。
<table>
<tr><th>面向</th><th>永續議題</th><th>風險評估</th><th>風險管理策略</th></tr>
<tr><td>環境E</td><td>永續發展策略</td><td>永續報告書</td><td>委任顧問輔導</td></tr>
<tr><td rowspan="3">社會S</td><td>人才招募與留才</td><td>人才庫不足</td><td>常態維持儲備業務人員及訓練並輪調各部門，培養成為跨部門/跨產品支援戰力</td></tr>
<tr><td>職涯發展與教育訓練</td><td>接棒人計畫</td><td>1.建立選才標準與接棒計畫表
2.接棒人進行管理知能與適性評估</td></tr>
<tr><td>產品品質/技術研發</td><td>量產品質</td><td>1.穩定技術能力
2.預備廠務發展所需系統</td></tr>
<tr><td>治理G</td><td>營運財務績效
客戶服務及供應鏈管理</td><td>營運風險</td><td>1.明確分工及提高組織效益
2.提供即時在地支援並改善與在地客戶的溝通效率，提升商譽與市佔率
3.建立客戶和內部團隊間的橋樑，提供技術和品質相關問題的現場支援</td></tr>
</table></td><td>無重大差異</td></tr>
<tr><td>三、環境議題
(一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？</td><td>V</td><td></td><td>(一)設有環境管理專責人員，推動環境管理運作及執行環保相關法規規定，且依產業特性，訂定「產品包裝、儲存管理程序」、「綠色產品管理辦法」、「機器設備管理程序」等相關辦法。並已取得「ISO 14001 環境管理系</td><td>無重大差異</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td>(二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？
(三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？</td><td>V
V</td><td></td><td>統」和「ISO 45001 職業安全衛生管理系統」的驗證(效期到 2026 年)。
(二)本公司致力於源頭改善，提升各項資源的利用效率，以減少廢棄物產生。例如銀漿擦拭布、包裝墨罐等含銀廢料回收，持續推動減廢及愛護地球之實際行動。
(三)
<table>
<tr><th>風險類別</th><th>風險類型</th><th>風險項目</th><th>潛在財務影響</th><th>因應策略行動</th></tr>
<tr><td rowspan="5">轉型風險</td><td rowspan="2">法規政策</td><td>上市櫃公司溫室氣體盤查規定</td><td>風險：為因應上市櫃公司溫室氣體盤查政策，將進行廠區溫室氣體盤查。根據盤查結果，優先汰換老舊設備，以減少潛在溫室氣體排放量。</td><td>進行溫室氣體盤查及查證
1.鑑別高耗能設備，並進行對應管理方案
2.持續推動製程改善，節能減排政策與行動方案制訂</td></tr>
<tr><td>勞工和環保法規持續變得更加嚴謹</td><td>風險：營運成本增加。</td><td>符合政府法規規範</td></tr>
<tr><td>科技風險</td><td>低碳原材料，低碳製程</td><td>機會：廢銀漿為可再回收利用高價物質。</td><td>持續與關鍵材料商密切合作，了解低碳材料開發時程</td></tr>
<tr><td>市場風險</td><td>能源成本上升，資源匱乏</td><td>風險：營運成本增加</td><td>減碳方案推動(2025 年新竹辦公室及工廠全面更換 LED 燈管)</td></tr>
<tr><td>供應風險</td><td>劇烈天氣(豪大雨)供應/運輸中斷</td><td>風險：供應商所在位置在劇烈天氣(豪大雨)時</td><td>初步檢視供應商、客戶無通報豪大</td></tr>
</table></td><td>無重大差異</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th rowspan="2">推動項目</th><th colspan="3">執行情形</th><th rowspan="2">與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因</th></tr>
<tr><th>是</th><th>否</th><th>摘要說明</th></tr>
<tr><td rowspan="5">(四)公司是否統計過去兩年溫室氣體排放量、用水量及廢棄物總重量，並制定溫室氣體減量、減少用水或其他廢棄物管理之政策？</td><td rowspan="5">V</td><td rowspan="5"></td><td rowspan="5">
<table>
<tr><td rowspan="3">實體風險</td><td></td><td></td><td>可能供應中斷。</td><td>雨災情，暫無因應策略</td></tr>
<tr><td>商譽風險</td><td>公司發生關於氣候變遷的負面新聞</td><td>風險：若出現負面報導或未投入環境保護等工作，可能會影響投資者和客戶的觀感。</td><td>發生機率很小，暫無因應策略</td></tr>
<tr><td>立即風險</td><td>極端天氣災害，如颱風、強降雨引發的水災，以及水資源匱乏，可能會導致供應鏈中斷，影響廠區的生產運作或造成設備損害。</td><td>風險：天災可能導致交通通勤受阻、設備損壞以及營運成本增加，從而影響公司營運。</td><td>公司所在區域(台中、新竹、高雄)沒有淹水風險，暫無因應策略</td></tr>
<tr><td>長期風險</td><td>電力供應不穩定，大氣溫度上升</td><td>風險：平均溫度上升導致用電量和碳排放增加。電力供應不穩定可能導致營運暫停或設備損害，從而增加營運成本。</td><td>本公司產品耗能很低，對大氣溫度上升影響微弱，暫無因應策略</td></tr>
<tr><td colspan="4">(四)本公司開始對溫室氣體排放進行自主盤查，113 年碳排放量(ton)統計如下：
<table>
<tr><th></th><th>範疇一</th><th>範疇二</th><th>合計</th></tr>
<tr><td>CO2e</td><td>109.035</td><td>304.729</td><td>413.764</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>
</td><td>無重大差異</td></tr>
</table>

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			本公司持續推動用水管理與優化措施，工廠用水量已降至最低，各區辦公室的用水量也納入全面管理，通過建立數據庫實現用水數據的精準追蹤與改善。 本公司工廠無廢棄物，僅有一般生活廢棄物產生，並由專業清潔公司處理。	
四、社會議題 (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫？	V V V V		(一)本公司支持並恪遵「世界人權宣言」、「公民與政治權利國際公約」及「經濟社會與文化權利國際公約」等重要『國際人權法典文件』、經國際勞工組織會員國 2/3 以上同意批准之『國際勞工公約』、及 1999 年 1 月 31 日聯合國秘書長科菲・安南（Koffi Anan）在世界經濟論壇中提出之『全球盟約（Global Compact）』等國際公認基本人權規範與台灣及中國各地法令規範，於 109 年參考包含國際勞動公約、聯合國世界人權宣言等規範，制訂本公司人權政策並公布於網站。 (二)本公司已訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），詳細內容請參考本年報(伍、營運概況 五「勞資關係」)說明；另本公司公司章程規定年度如有獲利，應提撥不低於 2%為員工酬勞，114 年 3 月 13 日董事會通過分派員工酬勞 7%。 (三)本公司於 112 年取得 ISO 45001 職業安全衛生管理系統」認證，依照不同工作崗位員工之需求，規劃系列教育訓練，培育同仁具有鑑別風險等級和預防風險的能力；亦作為組織內部自我檢視加以改善，以提供員工一個安全可靠的工作場所，減少員工發生事故和疾病的可能性，並符合法規要求。 本公司歷年未有職災事件發生。 (四)1.線上學習平台：111 年度導入學習平台以及線上課程錄製工具，除自製線上課程，也導入外部線上資源。透過系統化管理與混合式學習，提供員工多元、即時、彈性的學習方案，快速提昇職能強化員工素質，並有效整合訓練資源、保存工作知識與訓練紀錄。113 年將學習資源擴大應用至蘇州分公司，作為特定員工指定學習課程。並建立新人學程、新	無重大差異

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
			手業務學程，於員工入職時進行調訓給予完整且即時培訓。 2.舉辦內外訓練課程(113 年)： 內訓:職能課程 32 人時數、新人學程 49 人時數、通識學程 349.5 人時數，管理課程 22 人時數。共計 452.5 人時數。 外訓: 113 年度各類專業職能外訓共計 316.4 人時數。 3.設備操作認證：為提供人員專業的操作技能培訓，112 年建立認證機制，並錄製機台操作影片輔助學習。學科考試線上化、術科考試與認證名單亦透過學習平台進行系統化管理與保存。完善認證機制以確保人員安全與防範職災發生、維護公司資產、降低公司營運風險。 4.關鍵人才發展：113 年定義高階主管與初階主管管理職能清單，並於 114 年 Q1 針對人才庫成員進行管理職能測評。後續將據以規劃並執行個人發展計畫。	
(五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？	V		(五)在自有產品部份導入ISO9001 品質管理系統，依據所訂定之標準，用來檢視公司自有產品的品質及服務，以維持一定品質的品質管理認證系統。本公司自有產品皆有通過ECHA & RoHS檢測，以符合環保需求。購置檢驗設備加強IQC及OQC品質檢驗，並且模擬可靠性測試，強化產品穩定性，提供客戶優質產品減少客訴。 在代理產品部份有要求原廠出具歐盟檢測報告，以符合客戶對於環保或重金屬等標準。 本公司外部網站提供聯絡資訊、專有信箱供客戶聯繫、產品咨詢及客訴等服務，以確保客戶權益。	無重大差異
(六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？	V		(六)本公司依據已導入之 ISO9001 品質管理系統中，供應商評鑑管理規範所要求之品質、交期及配合度三大品項作為供應商評鑑要點，以抽核方式實地稽核數家主要配合廠商。	

推動項目	執行情形			與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？	V		本公司已著手進行編製永續報告書，於 114 年 8 月公告。	無重大差異
六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：規劃中。				
七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊：無。				

(六)氣候相關資訊執行情形

項目	執行情形
1. 敘明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。	1. 由董事會授權高階管理階層召集「永續發展小組」推動永續發展，擔任上下整合、橫向串聯的跨部門溝通平台。 2. 成立溫室氣體盤查與減量推動小組，負責推動節能減碳相關工作，每季開會追蹤，定期向董事會報告執行成果。
2. 敘明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務(短期、中期、長期)。	公司受氣候變遷相關法規規範之風險 1. 台灣已制定「溫室氣體減量及管理法」、「再生能源發展條例」等規範，公司將配合國家政策及善盡保護地球之責逐步改善溫室氣體排放。 2. 公司受氣候變遷之實質風險 短期實質風險：氣候變遷可能導致颱風、洪水、旱災等極端氣候事件，影響廠區的設備與運作。 中長期實質風險：極端氣候造成水、電、燃料等能、資源逐漸匱乏，可能導致工廠營運成本大幅增加。
3. 敘明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。	公司受極端氣候事件及轉型行動之實質風險 短期實質風險：颱風、洪水、旱災等極端氣候事件，可能影響廠區設備運作。 中長期實質風險：極端氣候造成水、電、燃料等能、資源逐漸匱乏，可能導致工廠停工。

<table>
<tr><th>項目</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td></td><td>
<table>
<tr><th>極端氣候衝擊</th><th>財務影響</th><th>採行對策</th></tr>
<tr><td>人員</td><td>人員無法出勤或傷亡，造成 ERP 系統維護與日常帳務工作流程中斷，影響經營資訊提供與產能損失。</td><td>系統異地備份與在宅出勤機制建立，降低營運中斷風險與對財務衝擊。</td></tr>
<tr><td>資產</td><td>土地建物設備損毀或滅失，除因資產重估影響財務報表外，另可能因產能降低營收減少導致現金流異常與財務體質惡化。</td><td>每年對集團各區建物貨物投保地震、火災爆炸等險種，彌補財產損失。</td></tr>
<tr><td>生產</td><td>極端氣候因素導致停電斷電情形發生，使設備使用產生重大影響及庫存品品質產生疑慮</td><td>重大設備建立不斷電系統緊急支應，使設備影響降至最低，長時且自動發電機系統規畫建立，讓須低溫維持之材料品質維持高規格保存</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>4. 敘明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。</td><td>氣候風險管理與推動單位
本公司由風險管理委員會負責監督，風險管理工作小組依據「風險管理政策與程序」，執行風險的辨識、分析、評估、控制等管理流程。並將氣候風險整合風險管理架構中，依程序進行風險辨識與評估，制定因應方針與策略後，由各權責單位執行，並向董事會報告執行成果。
氣候風險辨識
本公司氣候議題之風險與機會鑑別並建立有效的管理機制。每年透過環境考量面與風險機會管理程序，主要由技術部門、安衛室、管理部門共同參與，蒐集相關議題資訊作為風險評估之依據，由各部門以各部門專業的角度審視並評估與公司營運風險的相關性與風險度。
氣候風險評估
評估方法參照 TCFD 報告建議(Recommendations of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures, June 2017)，擬定風險情境時，考量轉型風險(政策和法律/市場/科技/聲譽)及實體風險(一般與緊急)；當財務衝擊金額超過 NTD500 萬元時(95%的機率發生在單一年度)，列為公司層級風險(具實質性財務衝擊)。
氣候風險回應
依據氣候管理單位核定的氣候風險胃納、風險回應的成</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>項目</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td></td><td>本效益、可能性與衝擊的降低幅度等因素，選用適當的風險回應方案，使其在實現目標與成本效益之間取得平衡。
氣候風險監督管理
風險管理工作小組每年定期向高階管理階層及董事會報告氣候風險管理相關資訊、執行情形，與後續追蹤改善事項、因應措施與策略目標等。
風險報導與揭露
風險管理小組執行之過程及其結果均應通過適當的機制進行紀錄、審查與報告，於公司網站或公開資訊觀測站中揭露氣候風險管理相關資訊，提供外部利害關係人參考，並持續更新。</td></tr>
<tr><td>5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之韌性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。</td><td>本公司參照 TCFD 建議書之「策略」章節指引，面對氣候的抗壓性同時考量到不同氣候相關情境，選擇使用 2 種情境來分析我們可能會遭受到的營運轉型衝擊與實體衝擊。
RCP 實體風險情境：
RCP 情境模擬下，我們使用臺灣氣候變遷推估資訊與調適知識平台(Taiwan Climate Change Projection Informationand Adaptation Knowledge Platform,TCCIP)，線上模擬在 RCP 8.5 RCP（代表濃度路徑），所遭遇到的最嚴重情況。對於溫度和降水的變化，在 RCP 8.5 中，溫度最高升高 1.67℃，最大降水變化量為 0.51mm/day。在對於溫度變化，在最壞的情況下，RCP8.5，溫度最多升高 1.67℃這將導致功耗增加 1%，總能源成本增加 1%，這是可接受的財務影響。</td></tr>
<tr><td>6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。</td><td>配合國家 2050 淨零碳排路徑，與金管會發布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，本公司透過辨識氣候變遷風險與機會，評估氣候相關風險對營運與財務之影響，並據此規劃相關管理氣候調適措施，推動各項節能減碳與友善環境的行動，導入與氣候環境相關國際管理標準，並依轉型計畫內容分次投入人力物力與資金，以期朝向的綠色供應體系目標邁進。
<table>
<tr><th>風險類別</th><th>風險類型</th><th>潛在財務影響</th><th>因應措施</th><th>目標與指標</th></tr>
<tr><td>轉型風險</td><td>法規政策</td><td>上市櫃公司溫室氣體盤查規定</td><td>進行溫室氣體盤查及查證
1.鑑別高耗能設備，並進行對應管理方案
2.持續推動製程改善，節能減排政策與行動方案制訂</td><td>2024 年開始溫室氣體盤查，2026 年第三方查證</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

項目	執行情形				
		法規政策	勞工．環境法規持續嚴謹	符合政府法規規範	外部稽核重大缺失件數為0
		科技風險	關鍵材料商新產品開發	持續與關鍵材料商密切合作，了解低碳材料開發時程	暫無
		市場風險	能源成本上升，資源匱乏	減碳方案推動(2025年新竹辦公室及工廠全面更換LED燈管)	更換燈組數量預估184盞，年度預估節電3,769.36度，減碳量預估1.786ton. CO2e
		供應風險	劇烈天氣(豪大雨)供應/運輸中斷	初步檢視供應商、客戶無通報豪大雨災情，暫無因應策略	高風險(可能淹水)廠商/代理商/客戶設定安全庫存或應急方案
		商譽風險	公司發生關於氣體變遷的負面新聞	發生機率很小，暫無因應策略	暫時可接受風險
	實體風險	立即風險	極端天氣災害如颱風、強降雨的水災及水資源匱乏而造成供應鏈中斷，影響廠區產區生產運作或是設備損害	公司所在區域(台中、新竹、高雄)沒有淹水風險，暫無因應策略	暫時可接受風險
		長期風險	電力供應不穩定，大氣溫度上升	本公司產品耗能很低，對大氣溫度上升影響微弱，暫無因應策略	用電密集度↓1%
7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。	無使用內部碳定價作為規劃工具。				
8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫	研擬規劃中				

<table>
<tr><th>項目</th><th>執行情形</th></tr>
<tr><td>室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。</td><td></td></tr>
<tr><td>9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫</td><td>母公司溫室氣體盤查及查證時程規劃：
<table><tr><th>工作項目</th><th>完成時間</th></tr><tr><td>訂定設置專（兼）職單位、專（兼）職人員人數及其職掌範圍</td><td>111 年 12 月</td></tr><tr><td>訂定盤查規劃</td><td>112 年 12 月</td></tr><tr><td>訂定查證規劃</td><td>114 年 12 月</td></tr></table>
合併報表子公司溫室氣體盤查及查證時程規劃：
<table><tr><th>工作項目</th><th>完成時間</th></tr><tr><td>訂定設置專（兼）職單位、專（兼）職人員人數及其職掌範圍</td><td>112 年 12 月</td></tr><tr><td>訂定盤查規劃</td><td>113 年 12 月</td></tr><tr><td>訂定查證規劃</td><td>115 年 12 月</td></tr></table>
本公司溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫，請詳第 6 項「轉型風險之指標與目標說明」。</td></tr>
</table>

1-1 最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形：

工作項目	利機母公司	合併子公司
揭露溫室氣體盤查	115 年揭露: 114 年度之盤查資訊， 並於後續年度持續揭露	116 年揭露: 115 年度之盤查資訊， 並於後續年度持續揭露
揭露溫室氣體查證	117 年度揭露: 116 年度之盤查資訊暨查證結果， 並於後續年度進行查證及揭露	118 年度揭露: 117 年度之盤查資訊暨查證結果,並於後續年度進行查證及揭露

1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫：

請詳(六)氣候相關資訊執行情形第 6 項說明。

(七)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
一、訂定誠信經營政策及方案 （一）公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ （二）公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ （三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，且落實執行，並定期檢討修正前揭方案？	V V V		(一)本公司已訂定經董事會通過之「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事及經理人道德行為準則」及「公司治理實務守則」等揭露於公司網站及公開資訊觀測站。誠信是本公司之核心價值也是經營企業之根本；此準則適用於本公司之所有董事、經理人及受僱人或具有實質控制能力者。 為使相關人員確實知悉並遵守且落實執行，公司建置小利學習機平台，追蹤每位同仁每年至少一次點閱紀錄。113 年度共 68 人完成誠信經營守則(0.5h)及人權政策宣導(0.5h)，完訓率 100%。 (二)本公司已於「工作規則」及「聘僱合約」中載明誠信相關規範，另訂有「內、外部人員對於不合法（包括貪污）與不道德行為的檢舉辦法」，對於作業程序、行為指南、教育訓練、違規之懲戒及申訴制度等皆有清楚及詳盡之規範。另於BPM、遠端連線進入公司檔案系統時，同仁先閱讀完畢保密條款才能進入檔案，以確保每次使用公司檔案時，已善盡告知同仁之責任。 113年起，規範研發人員應每年接受一次線上營業秘密課程。113年度研發完成營業秘密課程人數12人，課程時數1.5h，完訓率100%。 (三)本公司於「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」訂定防範不誠信行為方案，包含作業程序、行為指南，當員工發生不誠信行為時，均依情節之輕重依獎懲規定究處。	無重大差異
二、落實誠信經營 （一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ （二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與	V V		(一)本公司對於供應商及往來客戶依內控訂有評核機制，締約過程對於雙方之權利義務均詳列其中，並立有保密條款及不賄賂等誠信條款。 (二)本公司指定營運支援處為推動企業誠信經營專職單位，並於每年之第四季向董事會報告該年度誠信經營執行結果，協助董事會評估公司所建立之誠信經營防範措施是否有效運行。	無重大差異

評估項目	運作情形			與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
	是	否	摘要說明	
防範不誠信行為方案及監督執行情形？ （三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ （四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ （五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？	V V V		(三)本公司於「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「董事及經理人道德行為準則」中明確說明利益衝突政策及牴觸之情況/標準，並要求相關人員應予迴避，另制訂「內、外部人員對於不合法（包括貪污）與不道德行為的檢舉辦法」，適時、適當的提供陳述或檢舉管道，落實防止利益衝突之執行。 (四)本公司已建立有效之會計制度及內部控制制度，內部稽核人員依稽核計畫查核前項制度遵行情形，並定期向董事會報告。 (五)本公司定期提供主管機關誠信經營之宣導文件予董事，並依情況舉辦包含誠信經營內容的內、外部教育訓練。包括新人報到或選舉新任董事時均會說明公司之規章制度與行為準則。本年度已將相關文件、教材放入小利學習機平台，於113年10月辦理線上考試，確認受訓同仁已確實了解公司規範與法令，若未合格者則施以再教育。	無重大差異
三、公司檢舉制度之運作情形 （一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立便利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ （二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ （三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？	V V V		(一)本公司「內、外部人員對於不合法（包括貪污）與不道德行為的檢舉辦法」，指定權責單位處理申訴事務，並設有客服專線，依規定流程受理反映意見。 (二)本公司「內、外部人員對於不合法（包括污）與不道德行為的檢舉辦法」，明定檢舉陳報流程、審理單位，並承諾對陳報人及檢附證據予以保密。 (三)本公司「內、外部人員對於不合法（包括貪污）與不道德行為的檢舉辦法」，明定若被陳報檢舉者對陳報檢舉人有任何威脅或報復行為時，公司亦依相關規定予以懲處。	無重大差異
四、加強資訊揭露 公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？	V		本公司已制訂各項誠信經營守則制度，並將落實相關資訊揭露於公司網站，以提供社會大眾隨時檢視。	無重大差異
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：本公司於110年5月6日董事會通過「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，將依守則運作相關事宜。				
六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：無。				

(八)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：請至本公司網站或公開資訊觀測站查詢。

(九)內部控制制度執行狀況應揭露下列事項

1.內部控制聲明書:

利機企業股份有限公司

內部控制制度聲明書

日期：一一四年三月十三日

本公司民國一一三年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，謹聲明如下：

一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。

二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。

三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。

四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。

五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國一一三年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。

六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。

七、本聲明書業經本公司民國一一四年三月十三日董事會通過，出席董事7人中，無人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。

利機企業股份有限公司

董事長：張濬暉 簽章

總經理：黃道景 簽章

2.委託會計師專案審查內部控制者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議

日期	類別	重要決議事項
113.03.07 第十六屆 第十一次	董事會	1.一一二年度員工及董事酬勞分派案。 2.一一二年度營業報告書及財務報表案。 3.一一二年度盈餘分配案。 4.一一二年度盈餘轉增資發行新股案。 5.通過一一二年度公司內部控制制度聲明書。 6.本公司一一三年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 7.召開一一三年度股東常會案。 8.一一三年度股東常會受理持股1%以上股東提案之期間地點。 9.購置企業營運總部案。 10.修訂【員工酬勞管理辦法】案。 11.一一二年度董事暨經理人薪酬與績效評估結果之關聯性及合理性評估。 12.一一二年度董事酬勞暨經理人員工酬勞分配案。 13.一一三年度董事暨經理人薪酬結構及給付金額。
113.05.10 第十六屆 第十二次	董事會	1.一一三年第一季合併財務報表。 2.經濟部申請登記之公司印鑑章之專責保管人員案。
113.06.13	股東常會	1.一一二年度之營業報告書及財務報表承認案。 2.一一二年度盈餘分配案。
113.07.04 第十六屆 第十三次	董事會	1.訂定一一二年度盈餘分配案之除息、除權基準日及其相關事宜。 2.投資明鈞源精微科技股份有限公司。 3.員工酬勞提列比率調整案。 4.本公司經理人解任暨新任經理人委任及報酬案。
113.08.07 第十六屆 第十四次	董事會	1.一一三年第二季合併財務報表。
113.11.06 第十六屆 第十五次	董事會	1.更換簽證會計師案並重新評估本公司簽證會計師之獨立性及適任性案。 2.一一三年第三季合併財務報表。 3.訂定一一四年度稽核計劃。 4.修訂本公司【公司治理實務守則】、【審計委員會組織規程】及【董事會議事規範】部分條文案。 5.修訂本公司【風險管理辦法】案。
113.12.26 第十六屆 第十六次	董事會	1.一一四年度預算案。 2.一一四年度融資銀行及融資額度案。 3.處分轉投資利騰國際科技股份有限公司案。 4.修訂【內部控制制度】及【內部稽核制度】案。 5.一一三年度經理人年終獎酬案。
114.03.13 第十六屆 第十七次	董事會	1.一一三年度員工及董事酬勞分派案。 2.一一三年度營業報告書及財務報表案。 3.一一三年度盈餘分配案。 4.通過一一三年度公司內部控制制度聲明書決。 5.本公司一一四年度簽證會計師獨立性及適任性之評估暨委任案。 6.修訂【公司章程】案。

日期	類別	重要決議事項
		7.改選董事案。 8.董事會提名及審議董事(含獨立董事)候選人案。 9.解除董事競業禁止之限制案。 10.召開一一四年度股東常會案。 11.一一四年度股東常會受理持股1%以上股東提案及董事(含獨立董事)候選人提名之期間地點。 12.修訂【員工酬勞管理辦法】案。 13.一一三年度董事暨經理人薪酬與績效評估結果之關聯性及合理性評估。 14.一一三年度董事酬勞暨經理人員工酬勞分配案。 15.一一四年度董事暨經理人薪酬結構及給付金額。 16.經理人舊制退休金結清案。
114.05.07 第十六屆 第十八次	董事會	1.一一四年第一季合併財務報表。 2.購置鼎新T100 ERP暨相關模組。 3.修訂【董事會議事規範】部分條文案。 4.解除董事競業禁止之限制案。 5.解除經理人競業禁止之限制案。 6.經理人解任案。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，董事對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無此情形。

四、簽證會計師公費資訊

單位：新臺幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	會計師查核期間	審計公費	非審計公費	合計	備註
勤業眾信聯合會計師事務所	許瑞隆 蘇定堅	113.01.01~ 113.12.31	2,520	605	3,125	非審計公費主要係稅務簽證公費

(一)更換會計師事務所且更換年度所給付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費金額及原因：無此情形。

(二)審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：無此情形。

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更　換　日　期	民國一一三年十一月六日經董事會通過，自一一三年第三季起更換。		
更換原因及說明	配合簽證會計師事務所內部調整。		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	當事人 情　況	會計師	委任人
	主動終止委任	不適用	
	不再接受(繼續)委任		
最新兩年內簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因	不適用		
	無	會計原則或實務	

與發行人有無不同意見	無	財務報告之揭露
	無	查核範圍或步驟
	無	其　　他
	說明：無	
其他揭露事項(本準則第十條第六款第一目之四至第一目之七應加以揭露者)	無	

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	勤業眾信聯合會計師事務所
會計師姓名	許瑞隆、蘇定堅
委任之日期	民國一一三年十一月六日經董事會通過，自一一三年第三季起更換。
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	不適用
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	不適用

(三)前任會計師對本準則第 10 條第 5 款第 1 目及第 2 目之 3 事項之復函。不適用。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業資訊：無。

七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形

(一)董事、經理人及大股東股權變動情形

職　稱	姓　名	113 年度		114 年 4 月 14 日止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事長	張濬暉	24,213	0	0	0
副董事長	張惟森	9,567	0	0	0
董事兼執行長	張宏基	50,529	0	0	0
董事	韓商 SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD	38,323	0	0	0
董事之法人代表人	韓商 SIMMTECH HOLDINGS CO.,LTD 代表人李京洙	0	0	0	0
獨立董事	張嘉興	0	0	0	0
獨立董事	施明宗	0	0	0	0
獨立董事	蔡篤銘	0	0	0	0
總經理	黃道景	5,120	0	0	0
資深副總經理	池佳龍	0	0	0	0
副總經理	沈宇謙	(5,775)	0	0	0
協理	邱智芳	7,000	0	0	0
協理	盧修滿	(8,850)	0	0	0
公司治理主管	陳賢玲	1,158	0	0	0

(二)股權移轉或股權質押予關係人資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊

單位:股；114 年 4 月 14 日

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義合計持有股份		前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係者，其名稱或姓名及關係。		備註
	股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率	名稱	關係	
聚泰投資股份有限公司 負責人 張宏基	3,867,071	8.6%	0	0%	0	0%	張宏基	其董事長為本公司董事兼執行長	無
韓商 Simmtech Holdings Co.,LTD 負責人 PARK KWANG JOON	1,954,506	4.3%	0	0%	0	0%	Se Ho Chun	韓商 Simmtech Holdings 主要股東	無
PARK KWANG JOON	0	0%	0	0%	0	0%	韓商 Simmtech Holdings	韓商 Simmtech Holdings 董事長	無
ＳｅＨｏＣｈｕｎ	1,954,505	4.3%	0	0%	0	0%	韓商 Simmtech Holdings	韓商 Simmtech Holdings 主要股東	無
張宏基	1,834,866	4.1%	777,164	1.7%	0	0%	張濬暉 張韶恩 張廷宇	二親等內親屬	無
張競文	1,778,500	4.0%	0	0%	0	0%	張坤祥	二親等內親屬	無
張韶恩	1,543,213	3.4%	5,099	0%	0	0%	張宏基 張廷宇	二親等內親屬	無
張廷宇	1,391,486	3.1%	0	0%	0	0%	張宏基 張韶恩	二親等內親屬	無
張坤祥	1,274,149	2.8%	61,519	0.1%	0	0%	張競文	二親等內親屬	無
詹偉明	1,242,000	2.8%	0	0%	0	0%	-	-	無
張濬暉	1,234,872	2.7%	48,193	0.1%	0	0%	張宏基	二親等內親屬	無

九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例

113 年 12 月 31 日；單位：仟股；%

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
Advanced Corporation	1,800	100%	0	0	1,800	100%
STNC Hong Kong Holdings Limited.	490	49%	510	51%	1,000	100%
利騰國際科技(股)公司	633	30%	0	0	633	30%
Advanced Processing Equipment Technology Co., Ltd.	283	6%	0	0	283	6%
精材實業（股）公司	336	12%	0	0	336	12%
Global Simmtech Co.,Ltd.	148	1%	0	0	148	1%
強芳科技（股）公司	435	15%	0	0	435	15%
明鈞源精微科技股份有限公司	2,121	6%	0	0	2,121	6%
耀儒科技股份有限公司	1,360	17%	0	0	1,360	17%

參、 募資情形

一、 資本及股份

(一)股本來源

114 年 4 月 14 日

股份種類	核定股本			備註
	流通在外股份	未發行股份	合計	
普通股	44,996,877 股	5,003,123 股	50,000,000 股	上櫃股票

114 年 4 月 14 日；單位:仟股；仟元

年月	發行價格(元)	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外之財產抵充股款者	其他
113.08	10	50,000	500,000	44,997	449,968	盈餘轉增資 8,823仟元	無	113.8.5 府授經登字第 11307489750 號函核准

(二)主要股東名單

114 年 4 月 14 日

主要股東名稱	持有股數	持股比率
聚泰投資股份有限公司	3,867,071	8.6%
韓商ＳＩMMＴＥＣＨ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ　ＣＯ., LTD	1,954,506	4.3%
ＳｅＨｏＣｈｕｎ	1,954,505	4.3%
張宏基	1,834,866	4.1%
張競文	1,778,500	4.0%
張韶恩	1,543,213	3.4%
張廷宇	1,391,486	3.1%
張坤祥	1,274,149	2.8%
詹偉明	1,242,000	2.8%
張濬暉	1,234,872	2.7%

(三)公司股利政策及執行狀況：

1. 公司章程所定之股利政策

本公司每年決算後所得純益，除依法扣繳所得稅外，應先彌補以往年度虧損，次就其餘額加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額提存百分之十為法定盈餘公積，但法定盈餘公積累積已達本公司資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如尚有餘額，併同累積未分配盈餘由董事會擬具分配議案，以發行新股方式為之時，應提請股東會決議後分派之，以現金方式為之時，應經董事會決議。

本公司分派股息及紅利或法定盈餘公積及資本公積之全部或一部如以發放現金之方式為之，得授權董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數同意後為之，並報告股東會。

本公司股利政策，係配合目前及未來之發展計畫、考量投資環境、資金需求及國內外競爭狀況，並兼顧股東利益等因素，分配股東股息紅利時，依當年度新增之可分配盈餘，至少提撥百分之四十分派股東股利，得以現金或股票方式為之，其中現金股利不低於股利總額之百分之十。

2. 本次股東會擬議股利分派情形

113 年度盈餘分派案經 114 年 3 月 13 日董事會決議如下：擬配發股東現金股利新台幣 89,993,754 元，每股配發 2 元。嗣後如因本公司股本變動影響流通在外股數，股東配股率因此發生變動時，提請股東常會授權董事會全權處理。

(四)本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：本公司並未公開 114 年度之財務預測，故不適用。

(五)員工酬勞及董事酬勞

1. 公司章程所載員工酬勞及董事酬勞之成數或範圍：

本公司年度如有獲利，應提撥不低於百分之二為員工酬勞及不高於百分之三為董監事酬勞。但公司尚有累積虧損時，應預先保留彌補數額。

前項員工酬勞得以股票或現金為之，其給付對象得包括符合董事會所訂條件之從屬公司員工。

2. 本期估列員工酬勞及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理。

113 年度估列員工酬勞 11,049 仟元及董事酬勞 3,315 仟元，係分別按前述稅前利益之 7%及 2.1%估列。

年度合併財務報告通過日後若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於次一年度調整入帳。

3. 董事會通過分派酬勞情形

(1)以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額。

	配發金額(仟元)
員工現金酬勞	11,049
董事酬勞	3,315

(2)以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或個別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用。

4. 前一年度員工酬勞及董事酬勞之實際分派情形（包括分派股數、金額及股價）、其與認列員工、董事及監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形：無此情形。

(六)公司買回本公司股份情形：無。

二、公司債辦理情形：無。

三、特別股辦理情形：無。

四、海外存託憑證辦理情形：無。

五、員工認股權憑證辦理情形：無。

六、限制員工權利新股辦理情形：無。

七、併購或受讓他公司股份發行新股之辦理情形：無。

八、資金運用計畫執行情形：

截至年報刊印日之前一季止，前各次發行或私募有價證券尚未完成或最近三年內已完成且計畫效益尚未顯現者：無。

肆、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

1.所營業務主要內容：

(1) 半導體產業相關材料與設備之銷售。

(2) 光電產業 LCD 及 LED 相關材料與設備之銷售。

(3) 新興高科技領域及綠色能源產業相關材料之銷售。

(4) 奈米技術相關材料之製造與銷售。

2.營業比重：

單位：新台幣仟元

主要商品	113 年營業收入	營業比重(%)
半導體產品	698,171	61%
光電產品	432,811	37%
其他產品	22,504	2%
合　　計	1,153,486	100%

3.主要商品項目：

(1) 半導體產業：

A.封測相關

封裝用銲針(Capillary)、封裝用零組件(Machine Tool)、導線架(Lead Frame)、均熱片(Heat Sink)…。

B.記憶體 IC 載板

高階DRAM覆晶封裝用基板(FC-BOC)、記憶卡基板(FMC)、嵌入式多媒體卡載板/多晶片堆疊載板(eMMC/eMCP)、平面閘格陣列載板(LGA)、封裝體疊層載板(POP) …。

C.邏輯 IC 載板

覆晶封裝基板(FC CSP)、細間距球型閘格陣列/多晶片堆疊載板(FBGA/MCP)、平面閘格陣列載板(LGA)、系統級封裝(SIP)、高階整合式的大尺寸BT-base覆晶封裝基板(SILM FCBGA)…。

D.其他

真空閥門(Valve)、切割刀具、特殊氣體(Special Gas)…。

(2) 光電產業：

A.LCD_驅動 IC 相關

晶粒承載盤(IC/Chip Tray)、COF Tape 包裝用纏繞捲盤(Shipping Reel)、COF Tape 包裝用間隔帶(Emboss)…。

B.LCD_其他 LCD

金屬靶材(Target)、LED 發光材料(O-LED)…。

C.LED_封測相關

封裝用銲針(Capillary)、封裝用零組件(Machine Tool)…。

(3) 綠能及其他產業：

A.自製銀產品

網印銀漿(Screen Printing Paste)、客製化銀漿 (Customized Ag Paste)、燒結銀漿(Sintering Ag Paste)、導電/導熱銀漿(Conductive Ag Paste)…。

B.其他

氣體淨化設備(Gas Purifiers)…。

4.計畫開發之新商品（服務）：

持續開發各式銀漿系列產品，運用於車用電子、功率元件、IOT、AI、5G 等領域。

（二）產業概況

1.產業現況與發展：

本公司銷售的產品主要涵蓋三個產業，分別為半導體、光電及其他產業。

說明如下：

(1) 半導體產業

台灣在全球半導體供應鏈中扮演著關鍵角色，被譽為全球半導體產業的重要樞紐之一，享有卓越聲譽，擁有一系列龍頭企業，在製造、設計和封裝測試等方面都處於國際領先地位，具有競爭優勢。2024 年台灣 IC 產業產值達新臺幣 53,151 億元(USD$165.6B)，較 2023 年成長 22.4%，全球貿易持續擴張，政策不確定性攀升，有效關稅稅率達到一個世紀以來的最高水平，地緣政治與供應鏈面臨極大考驗，將以彈性供應鏈面對重要策略，增強供應鏈的韌性和靈活性，以因應未來複雜局面。展望 2025 年，AI 應用的持續擴張將推動相關電子產品升級，其中邏輯與記憶體領域有望成為主要成長動能，進一步帶動半導體產業的技術研發與市場發展。預估 2025 年全球半導體市場年成長率達 11.2%，整體市場規模達 6,979 億美元。

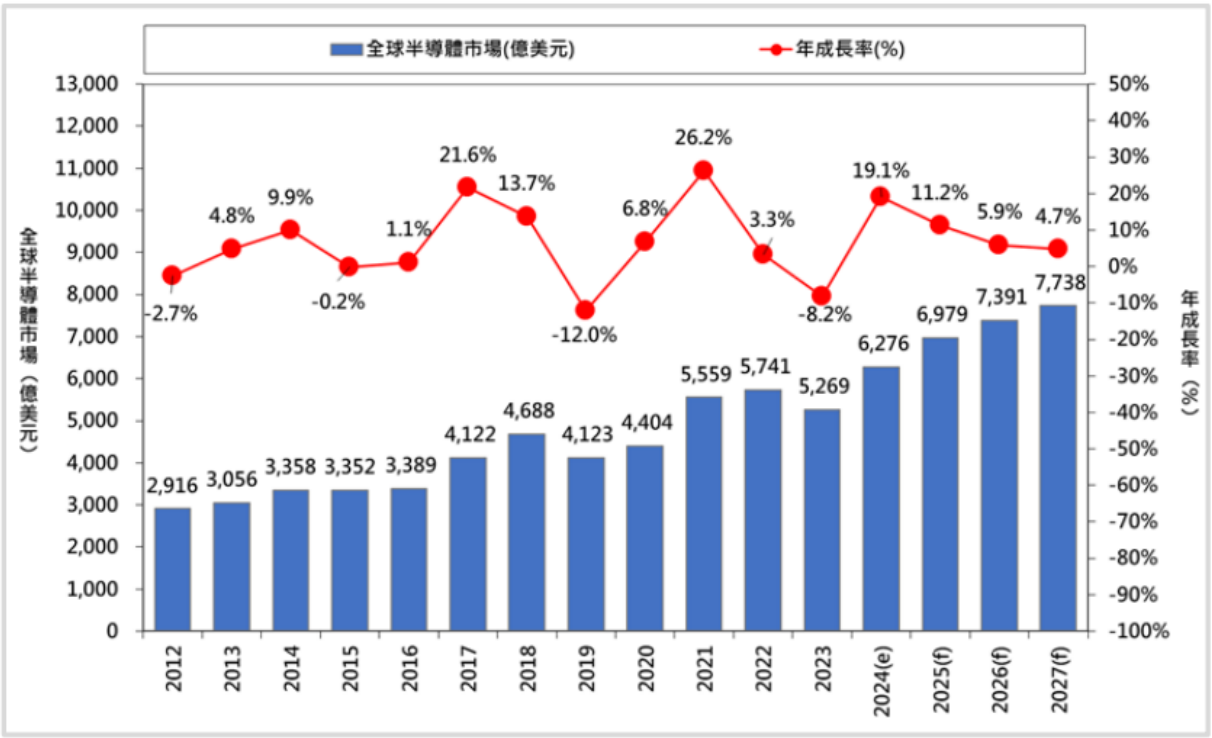
台灣在先進封裝領域擁有豐富的技術優勢、完善的供應鏈、產業集聚效應和政府支持，台灣封裝廠商不斷投資於研發，開發出了多種先進封裝技術，如先進系統封裝（ASP）、3D 封裝、Fan-Out 封裝、InFO、CoWoS 等，這些因素共同推動先進封裝產業的蓬勃發展，根據 DIGITIMES 資料顯示，2024 年台灣 IC 封測產值預估為 5,807 億新台幣，年成長 9.6%。主要因 AI 需求驅動，隨著生成式 AI 技術的崛起，對於高效能運算（HPC）和 AI 晶片的需求顯著增加，直接推升了 IC 封測產業成長。各台系封裝廠預期，AI 伺服器、AI 手機及 PC 等相關產品將持續成長，帶動整體營運表現，加上高階封裝需求提升，隨著科技進步，高階封裝技術如異質整合、高效能封裝等受到重視，這些技術的應用不僅提高了產品性能，也促使更多客戶選擇台灣的封測服務，以滿足其高標準的需求。

展望 2025 全年 IC 封測業，AI、HPC 高階晶片需求仍不輟，促使先進封裝提高互連效能的重要性日益顯著，在 AI 應用的蓬勃發展下，領導封測業者積極布局該領域，預估 2025 年臺灣 IC 封測業產值為新臺幣 6,803 億元，年成長 9.1%。

台灣半導體產業產值發展趨勢

資料來源：工研院產科國際所

全球半導體產業產值發展趨勢



註：數據源自於 WSTS 於 2024 年 12 月及 2025 年 02 月發布之全球半導體市場預測數據
資料來源：工研院產科國際所

(2) 光電產業

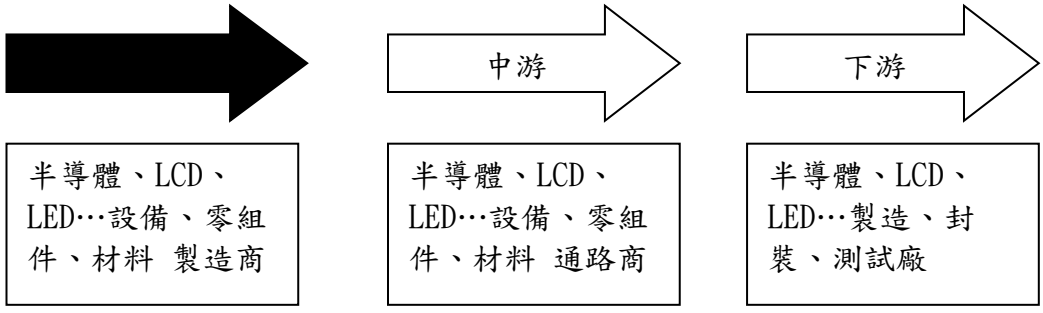
光電技術的應用範圍廣泛，包括太陽能、LED、雷射二極體、影像感測器、光耦合器和光伏電池等，目前光電產業面臨多重挑戰與機會，由於全球經濟不穩定及通膨影響，光電產品的需求出現波動，部分客戶需求趨緩，加上美國對等關稅的不確定因素，恐影響成長動能。不過，隨著 AI 和高效能運算（HPC）需求的增加，許多光電公司正在進行數位轉型以適應新的市場環境，針對半導體提升效能、運算加快與節能需求推動覆晶封裝的量產體系建構計畫，以抓住未來成長機會。

2024 年台灣光電產業的總產值將達到新台幣 15,585 億元 主要受惠影像感測、平面顯示器和光通訊等領域的推動，其中，平面顯示器產值預計達到 7,785 億元，光通訊產值為 1,441 億元，而太陽光電產值則為 726 億元。總體而言，光電產業正處於一個變革的時期，雖然面臨不少挑戰，但透過技術創新和市場策略調整，仍有潛力實現增長。

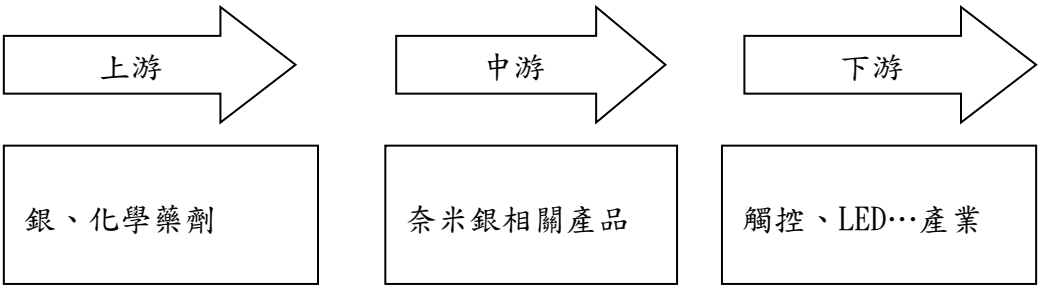
展望 2025 年，隨著大尺寸顯示器需求的增加，光電產業在顯示材料和技術上持續創新。特別是在 OLED、Mini LED 及 Micro LED 等高階顯示技術的應用上，這些技術不僅提升了顯示效果，也促進了更薄、更輕的產品設計，光電產業正朝向更加智能化、多樣化的方向發展，並在各行各業中尋求新的應用機會，以適應快速變化的市場需求。

2.產業上、中、下游之關聯性

①通路事業部部份



②製造事業部部份



3.產品之各種發展趨勢：

依本公司主要產品說明分析如下：

(1)封測相關(Capillary、Machine Tool、Lead Frame、Heat Sink)

近年來在 AI 引領風潮下，造就許多導入 AI 應用的產品(PC/伺服器/手機)問世，預料將是當前消費性電子產品需求低迷的一項轉機，利機所代理的 SPT Bonding Tool 一直是客戶於高精密度與高可靠度要求的最佳合作夥伴。SPT

Bonding Tool 精密加工能力與穩定性將協助客戶縮短研發時程並提前布局卡位來取得商機。

5G、AIoT、高效運算(HPC)、車用電子等科技發展趨勢持續起飛，連帶帶動週邊封裝材料需求揚升，利機代理 DNP 生產之蝕刻 Dual Row QFN 導線架，可取代傳統封裝型式之 QFP(Quad Flat Package)or BGA(Ball Grid Array) 100~180 pin 產品，並帶來封裝成品體積縮小與材料成本下降的優點，再者 QFN pad 背面外露的設計，散熱效果優於其它封裝方式，因此採用的封裝廠逐漸增加中且各封裝廠也積極向其客戶推廣，隨著晶圓製造技術提升(5nm->3nm->2nm..)，散熱將成為晶片設計與晶片封裝的顯學 QFN 的需求將持續成長。

晶片微小化，功能極大化的 IC 設計趨勢，產品散熱的需求與日俱增， 具有高熱傳導的介質，Flip chip 均熱片可提供高效率的排熱路徑，讓熱量從電子元件導出並轉移到周圍空氣中，成為目前覆晶封裝中不可或缺的組件之一，另外，相關 HPC、3D package、SIP package 大量廣泛被運用的情況，IC 運行時將更容易產生高熱，為了確保 IC 正常運行，均熱片的運用將更為普遍。

(2)各類記憶體 IC 載板(FC BOC、LGA、POP、eMMC/eMCP)

2024 年在 AI 應用持續升溫的推動下，全球資料中心建設熱潮未減，進一步驅動高階記憶體（HBM）與高速儲存需求快速成長。儘管受到通膨壓力與區域政治不確定性影響，終端市場回溫仍較預期提前出現，記憶體產業延續「庫存去化 + 價格回升」雙軌發展，全年呈現穩健復甦態勢。記憶體產品應用從儲存邏輯向協同運算邏輯轉型，隨 AI 伺服器、自駕車、邊緣運算等高算力需求擴大，記憶體載板的重要性與內容價值持續提升，驅動多層、高頻寬、高密度的製程需求加速普及。

(3)各類邏輯 IC 載板(FC CSP、LGA、FBGA/MCP、SiP、LGA 、SILM FCBGA)

2024 年雖受到地緣政治風險及美中科技貿易戰持續升溫影響，整體半導體供應鏈面臨高度不確定性，但在 AI 應用爆發、終端庫存去化完成及市場回補效應支撐下，記憶體與邏輯 IC 市場皆明顯回溫。生成式 AI 應用對高頻寬記憶體(HBM)與低延遲 DRAM 需求持續推升，帶動多層薄型記憶體載板及高複雜度封裝技術蓬勃發展。另一方面，隨著電動車與車載電子普及，具備高可靠度與車規認證能力的 IC 載板產品需求同步提升。展望 2026 年，產品差異化與加快 Time to Market 開發節奏將成為競爭關鍵，供應商需具備快速打樣、設計協同與技術整合能力，才能搶占 AI 與先進封裝商機。

(4)驅動 IC 相關(IC/Chip Tray、Emboss、Shipping Reel)

利機佈局驅動 IC 產品，都是面板驅動 IC 輸送時使用的承載&包裝材料,是目前市場廣泛使用的標準產品,外觀規格幾乎都已標準化,而利機的市占率較同業高，且有自主技術能力，可偕同客戶開發較高技術門檻產品,例如 Chip tray warpage 由<100um tighten 至<85um or 75um 或者相關尺寸 tolerance 由+/-100um tighten 至+/-50um or +/-30um，以及

Emboss spacer & Shipping reel 則偕同客戶開發 125mm 寬度的產品&封裝廠內部製程使用之耐高溫 emboss 以增加產品的深度與廣度，無論面板驅動 IC 採用哪一種封裝技術，利機均可提供符合市場主流產品。

(5)其他 LCD(OLED 發光材料)

顯示螢幕的發展，從笨重的 CRT 到輕薄的 LCD，近十年又多新技術 OLED，該產品具有低電壓、高效率、長壽命、熱穩定性佳、利於量產。

(6)奈米銀相關產品(Nano Ag related products)

觸控銀漿：

利機企業自主開發之觸控銀漿產品,適用於投射式電容觸控面板之網印及雷雕製程，符合觸控面板之發展趨勢。對於應用於軍事、工業、醫療、航空、航海等特殊領域之觸控面板業者，亦可滿足其客製化銀漿之需求。

此外，利機基於長期深化膠材研發的能量，於 2024 年投入異方性導電膠研發,不同於一般導電膠,異方性導電膠水平方向不導電,僅提供 Z 方向導電,因此提供應用場域使用便利性並取代實體連接器已達成縮小化目標,主要應用場域為 RFID、以及電子產品內部的電性連接，如：相機模組，軟板連接等。

燒結銀漿：

隨高功率產品需求越來越高，伴隨而來的高導熱需求不僅讓具有高導熱特性且能於低溫燒結的燒結銀膠成為第三類半導體車用、射頻 IC、感測器及高功率照明固晶方案,也因其高溫耐受力成為高功耗高速運算晶片封裝內的熱介面材 TIM1 方案。對比其他熱介面材，如錫膏或 Indium 高溫下會熔融，燒結銀漿突出的高溫工作能力使其成為熱門產品。

4.競爭情形：

依本公司主要產品說明分析如下：

(1) 封測相關(Capillary、Machine Tool、Lead Frame、Heat Sink)

SPT 銲針是國內 OSAT 打線首選,現有市占率 60%~70%以上,在許多 AI 產品(PC/伺服器/手機)即將問世，相關 IC 市場需求將有所反轉，OSAT 也積極佈置高階封裝能力，其 Bonding Tool 設計與開發也與 SPT 積極合作並量產中，SPT 持續開發特殊 Bonding Tool 設計協助 OSAT 更快進入高階封裝量產，我們一本初衷，以品質優先，用服務取得認可，與客戶一起攜手努力，互相支持，達成客戶，SPT，利機三贏。

大日本印刷(Dai Nippon Plating,簡稱 DNP)擁有堅強且厚實的金屬蝕刻技術與經驗再加上同時具備兩種電鍍方式(mechanical plating & photo plating)以及金屬表面粗化技術(AME)用以增加封裝時 L/F 與封裝樹脂的結合度，DNP photo plating 能提供更精密的 tolerance(Normal +/- 50un; DNP +/- 30um)有相對的技術優勢。

利機 Heat Sink(均熱片)的協力廠商 MCY 具有充足的銅材/鋁材/不銹鋼的高精密沖壓技術，客製化生產，是台系封裝廠的合格供應商，新開案時優先取得設計圖面，快速提供適合型號及方案，爭取新訂單，在材料取得及交期準時且品質確保下，客戶服務等相關表現優於同業，主要的競爭對手為兆點,昂闊,健策(金利)等。

(2)各類記憶體 IC 載板(FC BOC、LGA、POP、eMMC/eMCP)

隨著 DRAM 全面導入 DDR5 與 LPDDR5X 世代、NAND Flash 朝 PCIe Gen 5 與

CXL 介面規格邁進，Simmtech 集團憑藉領先的 mSAP 與薄板製程能力，積極協助記憶體客戶開發新一代高階模組。集團堅持「一站購足」(One Stop Shopping) 策略，強化核心製造與技術服務整合，並透過韓國、日本、中國、馬來西亞等多據點彈性生產優勢，成功因應地緣政治與供應鏈風險，展現卓越韌性。利機企業在台灣的技術支援與市場敏銳度亦成為深化客戶關係的重要助力，進一步拉高客戶黏著度與 ASP 表現。

(3)各類邏輯 IC 載板(FC CSP、LGA、FBGA/MCP、SiP、LGA 、SILM FCBGA)

Simmtech 集團在記憶體載板領域長年累積的市場聲譽，搭配中國、美國、台灣間貿易與技術制裁政策轉變下所產生的在地化需求，成為主要客戶尋求低風險、高彈性供應鏈配置的重要選項。透過韓國、日本、中國、馬來西亞四地分散生產據點與自動化良率優勢，Simmtech 持續推廣 One Stop Shopping 策略，除延伸記憶體 IC 基板技術應用至高階系統級封裝(如 SLIM FCBGA)、高速通訊 IC 及汽車應用外，也積極開拓中小尺寸邏輯 IC 載板領域。利機企業作為台灣區專業代理與在地技術服務窗口，結合快速反應能力與市場洞察，協助客戶應對全球供應鏈重組下的新挑戰。

(4)驅動 IC 相關(IC/Chip Tray、Emboss、Shipping Reel)

Shipping reel & Emboss 已成為台灣主要 film tape maker 和各 COF 封裝廠的主要供應商，因應大陸市場陸續成立新的 film tape maker 及 COF 封裝廠，透過利機蘇州分公司積極布局，持續穩定出貨。 Chip Tray 目前台灣市場主要的競爭者均為 local maker，利機的產能與技術能力均領先競爭者，主要客戶均為長期合作夥伴，關係深厚，市佔率也比同業高。

(5)奈米銀相關產品(Nano Ag related products)

觸控銀漿：日本及韓國雷雕銀漿供應商，包括(日本)Asahi、Toyobo, (韓國)Inktec..等，為早期切入投射式電容觸控面板之業者，具備先行者優勢。中國大陸廠商(包括銳新科, 貝特利等)則憑藉價格優勢主宰中低階市場。利機產品在兩面夾擊的環境下，透過更好的產品良率、更迅速的服務和既有客戶持續穩定發展成長，並尋求新客戶商機。

燒結銀漿：低溫燒結銀國際大廠包含 AAM, Namics, Henkel, Heraeus 及 Kyocera 等，在國際知名度和資源皆具備著領先地位。近年國內陸續有廠商投入低溫燒結銀的開發，使得市場的競爭狀況逐年提升。雖然市場越趨競爭，且低溫燒結銀材料特性需與錫膏比較，使得截至今日市場皆尚未有明顯且強勢的領導廠商或產品出現，但燒結銀的導熱特性加上可靠度表現，燒結銀市場規模後續持續看漲，也讓燒結銀產品市場充滿了機會。

通過全球銷售渠道，利機持續積極地向功率半導體行業的全球主要參與者推廣產品。近幾年進行許多測試和評估，並獲得非常積極的結果和反饋。我們預計於 2025 年開始放量生產出貨。

（三）技術及研發概況

1.最近年度及截至年報刊印日止，投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

年度	113 年度	114 年截至 3 月 31 日
研究發展費用	32,758	9,608
營業收入淨額	1,153,486	301,151
占營收比例	2.84%	3.19%

2.近年開發成功之技術或產品:

研發項目	技術特色與產品應用	未來成效
奈米燒結銀膠	建立自有奈米銀及配方技術，開發適用於大尺寸晶片封裝用之低溫燒結銀，為市場上少有的特色產品。可應用於高功率元件、高速運算元件、功率放大器等高階封裝產品。	一一三年通過多家客戶認證，正進行小量試產中，並積極拓展至更多國內外客戶應用產品，以擴張市場及產品線。
高導熱銀漿	應用於 LED/半導體封裝之高散熱固晶材料。具高散熱(>30W/mK)及高接著強度，提供封裝元件滿足高壽命、高可靠度需求，應用於車用功率元件及 LED 燈等。	已獲得台灣 LED 及功率元件廠驗證通過。積極推廣導入客戶端量產，以爭取更多獲利。
客製化銀漿	以多年銀漿開發經驗為基礎，開發出異方性導電膠，並具快速固化特性，可應用於電子組件構裝。未來持續尋找新應用市場，拓展異方性導電膠產品線及應用領域，轉換成未來營運動能。	一一三年進入美系大廠供應鏈，正進行最後產品驗證中。有望持續拓張產品線及供應量。

（四）長、短期業務發展計畫

1.長期業務發展計畫：

(1)定位利機為整合型材料供應商，以市場行銷、售後服務、研發技術、生產製造等深化產業供應鏈。

(2)落實三贏準則-客戶贏、供應商贏、利機企業贏；追求互信、互利的夥伴關係。

(3)積極發展自有先進材料，將研發技術發展至車用電子、功率元件、IOT、AI、5G 等，使產業版圖布局趨完整。

(4)緊密跟隨政府高科技產業政策，適時跨入新產業，引進世界各國先進技術材料與設備，維繫利機的成長動力。

(5)配合全球節能減碳政策，跨足綠色節能產業。

2.短期業務發展計畫：

(1)自有研發之銀漿開發策略：

燒結銀膠、導電銀漿及客製化銀漿將選擇重點客戶、集中資源深耕具有成長潛力的市場；聚焦具優勢之高散熱、高導熱及快速固化技術，開發價值

型產品。

(2)均熱片拓展策略：

AI 新應用與高階封裝需求帶動散熱相關市場的成長，利機聚焦 IC 散熱解決方案，除了致力於自有產品之技術創新與突破深化散熱應用之導熱銀膠及燒結銀膠，並將持續推動併購或聯盟以掌握三大製造技術(沖壓、金屬加工、電鍍)，延伸產品線至高階市場，以成為 CoWoS 供應鏈成員為目標。

(3)載板成長策略：

STN 團隊結合銷售能力及在地技術服務，透過與三大記憶體廠的緊密客戶黏著度以及高階 SOCAMM HDI 和針對 AI Server 所開發的下世代繪圖記憶體載板(GDDR7)，並搭配與封測廠邏輯 IC 領域戰略合作協議，將提升整體營收貢獻。且藉由資源戰略部屬於邏輯 IC 領域，新產品及專案導入案件近年均有顯著成長，將持續帶動邏輯 IC 營收成長並提升比重。

(4)其他產品成長策略：

營運主力之驅動 IC 相關、封測相關、OLED 及各項新代理產品，除掌握終端需求回溫、AI 大放異彩之商機，也持續擴展電子標籤、車用面板領域及 AR/VR 應用新需求，將 114 年業績再往上推升。

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1.主要商品(服務)之銷售(提供)地區：

單位:新台幣仟元

年度 銷售地區	113 年度	
	銷售金額	比重(%)
內銷	664,896	58%
外銷(亞洲及其他地區)	488,590	42%
營業收入淨額合計	1,153,486	100%

2.市場占有率概述：

本公司持續建構成為整合型材料供應商，並建立完整供應鏈銷售網，提供全方位的加值整合服務，包括技術支援、專業諮詢、運籌管理等等，與客戶建立長期的夥伴關係，來達到客戶、製造商、利機三贏的局面。主要含概半導體、光電、綠能等產業相關耗材及設備之專業代理商，產品之領域非常廣泛，茲依本公司主要產品說明分析如下：

(1) 封測相關(Capillary、Machine Tool、Lead Frame、Heat Sink)

利機所代理 SPT 產品，在 OSAT 客戶群均為業界領導廠商，目前市場佔有率約 60%~70%以上，車用 IDM 客戶為 90%以上的佔有率，近來各大廠積極提升先進封裝製程能力，發展高階封裝、異質整合產品、車用電子產品，對於利機的市場擴充將有正面的助益。

另代理 DNP 公司的 QFN L/F 導線架，目前專注於高階的 photo plating QFN L/F，在大中華市場(台灣 & 大陸)的出貨量約 250k strips/M，DNP 現階段的生意模式採與 IDM 客戶簽長期合約,雖整體市占率不高,但需求較不會隨市場需求而產生巨幅波動。

均熱片於2017起加入利機代理銷售行列，每年持續正成長，目前為台系封測大廠散熱材料供應商，供應廠商增加中並持續取得新型號訂單，且增加技術門檻高的大尺寸均熱片出貨量，市佔率逐年增加中。

(2) 各類記憶體IC載板/邏輯IC載板(FC BOC、LGA、POP、eMMC/eMCP、FC CSP、LGA、FBGA/MCP、SiP、LGA 、SILM FCBGA)

2024年在整體市場回溫與AI伺服器滲透率大幅上升的助力下，Simmtech集團全年營收來至8.94億美元，重返成長軌道，穩居全球記憶體IC載板市場第七大供應商。台灣區業務透過利機企業與STN團隊共同拓展，成功取得更多領先客戶之量產專案，為未來進一步擴張打下基礎。面對2025年美中貿易戰及高科技供應鏈去風險化政策所帶來的關稅與政策不確定性，集團將強化全球產能布局與在地化服務，爭取成為客戶供應鏈重組的首選合作夥伴。

(3)驅動IC相關(IC/Chip Tray、Emboss、Shipping Reel)

Shipping reel & Emboss幾乎已通過台灣所有LCD驅動IC設計公司的認證，已成為台灣主要film tape maker和各COF封裝廠的主要供應商，目前市占率約80~90%。

Chip Tray目前市占率約50~60%。

3.市場未來供需狀況與成長性：

(1)封測相關(Capillary、Machine Tool、Lead Frame、 Heat Sink)

隨著Wafer奈米級數越來越小與先進製程的產能開出，封裝廠的線徑也將越縮越小，加上特色化專利型產品的需求，如異質整合封裝型態，利機所代理SPT細線徑的封裝產品,最小公差的精密技術，對於高精密度與高穩定性的Bonding tool需求將會日趨強烈，而針對近期最夯AI電子零組件所需求的傳統封裝與高階封裝,追求高精密、高穩定良率、高可靠度驗證、高作業性，SPT銲針研發特殊設計將協助客戶解決問題，進而掌握AI產品IC封裝訂單，SPT Filp Chip 高精度解決方案在高階封裝設備，應用面也逐年增加，加上SPT的機動性與利機對市場脈動的掌握，兩者緊密的結合，將會是未來客戶與利機成長的來源。

QFN具輕薄小的特性，符合移動性電子產品的需求，故需求量會持續增加，在相同的IC腳數比較下，採用QFN封裝方式在尺寸縮小與材料成本上比BGA(Ball Grid Array)或QFP(Quad Flat Package)更具優勢，故各IC設計公司均積極評估中，後續的需求將逐漸增加。利機2022 Q2起已經跟IC設計商正式簽訂長期合約，包含產能供應與定期技術研討合作，藉此來獲得更穩定的需求與加速技術的提升。

各OSAT 持續擴充相關覆晶封裝產能, Flip chip 均熱片需求同步擴大,目前IC設計以晶片微小化,、功能極大化為主流趨勢，覆晶封裝應用將持續擴大，Flip chip 均熱片,散熱的角色及功能也將被大量運用。

(2)各類記憶體 IC 載板(FC BOC、LGA、POP、eMMC/eMCP)

2024 年記憶體 IC 朝向更高效能與更高堆疊密度發展，主流載板產品層數已進一步邁向 6 層至 8 層，且成品厚度要求更為嚴苛，推升高階製程與材料使用比例。生成式 AI 驅動下，AI 伺服器對 DRAM 與 NAND 的用量遠超傳統架構，進一步拉動 FC-BOC 與 LGA 產品需求。此外，本公司多年深耕的超薄型 3L Mobile PoP 載板已再度打入多家旗艦型智慧型手機平台，搭上手機市場復甦與換機潮，為下半年營收增添強勁動能。2025 年可望在 AI 與 Mobile 雙主線拉動下，持續擴大應用廣度與出貨規模。

(3)各類邏輯 IC 載板(FC CSP、LGA、FBGA/MCP、SiP、LGA 、SILM FCBGA)

儘管全球高利率與終端消費復甦仍具挑戰，但伺服器、手機與 PC 汰舊換新週期已開始啟動，且以生成式 AI 為核心的 HPC 與邊緣運算推動高階封裝需求持續攀升。ABF 產能過剩議題延續至 2025 年，使許多同業陷入稼動壓力，而 Simmtech 則因聚焦 BT-base 產品並導入高階 SLIM FCBGA 方案，反成差異化競爭優勢。SLIM FCBGA 因其相較 ABF 具備成本與結構彈性優勢，成功導入高速介面 IC、SSD 控制器、車載處理器等應用，未來成長性可期。

(3) 驅動 IC 相關(IC/Chip Tray、Emboss、Shipping Reel)

OLED 驅動 IC 現階段以 COF 封裝為主流,隨著 OLED 應用增加,可望為 Emboss、Shipping Reel 帶來動能。

5G 智慧手機持續刺激滲透率提升，加上中國面板廠在 2022 年擴大 OLED 產能。AMOLED 手機用面板滲透率逐漸提升，COP 的 Chip tray 需求慢慢回升。而經濟前景不明，產業和就業狀況不佳，內需後疫情消費疲弱，新機市場不振，更多消費者轉向購買性價比高產品如 TDDI 手機。維修市場面板需求也有增加。

(4) 其他 LCD(OLED 發光材料)

本公司代理銷售 Dupont 製造的 OLED 發光材料，具備完整的 IP 專利佈局，其紅色發光材料有超過八成的全球市場佔有率，隨著中國 OLED 面板產能增加且技術及競爭力不斷提升，發光材料的需求將隨之成長。

(5) 奈米銀相關產品(Nano Ag related products)

回顧 2024，工商業用 IPC 產業因過去兩年備貨庫存水位較高，但利機憑藉深耕台灣軍工控面板廠多年，改善並提供高良率的雷雕銀漿解決方案於 2024 繳出不錯的成績單，放眼 2025，除了提供市場優質產品外，面對地緣政治的國際局勢，利機也會深化供應商及成本管理，已達成 2025 的目標。利機於 2024 年已獲得 RFID 產業測試通過，於 2025 開始將進行目標市場推廣，如：相機模組、智慧手錶等對於空間尺寸有要求的產品，並配合台灣 ICT 產業客戶開發薄型化產品。

功率離散半導體 2023 年產值約為$385 億，2024 年將成長 5.4%至$406 億元，至 2027 年市值上看$516 億美元。而用於功率半導體的燒結銀漿是晶片連接材料的新市場領域。目前，其在整個半導體晶片黏接材料中的市場份額還不到 10%。然而，隨著 GaN 和 SiC 的第三類半導體的出現，以及在電動

汽車、工業控制和家用電器等多種應用中不斷提高的能效要求的推動下，加上伴隨高速運算而來的 TIM1 需求將成為燒結銀的新領域，其在未來 10 至 20 年內的成長潛力巨大。

利機除持續和數家國際功率元件及射頻大廠合作燒結銀開發案，也與邏輯 IC 國際大廠合作 TIM1 開發案。此外，我們也在台灣市場與一線封裝廠與功率元件商進行合作，提供在地的解決方案。

透過國內外專案的發展，我們預計到 2027 年利機的奈米銀燒結材料將達到 10%的市場份額，這相當於年銷售金額 1,000 萬美元。我們將持續透過全球的銷售網絡持續和國外主要的功率半導體業者進行合作，並加速我們在中國主要市場的推廣，同時藉由台灣地緣優勢，搶得與一線封裝廠的合作先機。。

4.競爭利基

本公司為業界極少數兼具半導體、光電及綠能等產業各領域通路實力之廠商，茲就主要商品分析其競爭利基如下：

(1) 封測相關(Capillary、Machine Tool、Lead Frame、 Heat Sink)

SPT 始終專注於 Bonding Tool 產業，擁有世界獨一的陶磁鑄模技術，SPT 銲針為一體成型鑄模生產，鑄模尺寸即為產品尺寸(客戶所需尺寸)，與其他競爭者為壓模後經多次加工達到客戶所需尺寸不同，所以在品質，尺寸的精密度與變異性上相對穩定。SPT 並擅用本身陶磁鑄模能力，製造差異，除大幅降低批間差異，與最小公差之產品外，Bonding tool 陶瓷材料不間斷的進步使 bonding 使用壽命穩定且遠超越同業，並推出多項專利產品，以技術能力領先同業推出客製化之特殊運用之 Bonding Tool 產品，不斷突破自我，研發設計特殊 Bonding Tool 表面製程，提升客戶打線品質與產能，來滿足客戶全方位的需求，並築起與競爭對手之間的鴻溝，另外利機提供專業技術服務團隊，提供客戶專業諮詢建議，也隨時能配合客戶進廠技術支援，解決客戶問題。

在同腳數的整體封裝考量下 QFN 比 GBA 或 QFP 更能達到輕、薄、短、小的效益，且材料的成本更具優勢。如果跟傳統 QFN 比較，QFN 有內引腳設計，可以節省金線(Gold wire)，封裝成本更具優勢。加上 QFN 體積小，類似 CSP(Chip Scale Package)封裝型態，成本相對便宜，具有降低熱阻的特性，因不需要從四邊引出接腳，故電性效能極佳，非常適用於中、低腳數的高速/高頻系統產品。

利機在半導體封測供應鏈的中低階市場已累積一定知名度，並積極開發高階市場，將協助協力廠商 MCY 建構完成化學掛鍍鎳生產線，並取得客戶認證量產，可以有效降低化鎳委外的管理成本及品質疑慮，後續為擴大相關產品線，協助 MCY 建構電解電鍍產線，讓產品線更完整，並同步開拓相關新客戶群, 以擴大市佔率及獲利成長空間。在推廣的策略上，利機會利用在半導體材料，封裝市場中的廣大人脈網絡,朝 IC 設計公司推廣以期 IC 設計公司 design in 利機的均熱片，擴大利機散熱片的產品應用面.

(2) 各類記憶體 IC 載板 (FC BOC、LGA、POP、eMMC/eMCP)

記憶體載板技術已全面導向 Coreless 多層設計，並導入更高階的 mSAP 製程與 ETS 內嵌線路技術，以支援高頻寬、細線寬與高可靠性需求。Simmtech 集團於 2024 年完成韓國與馬來西亞兩地新產線擴建並導入次世代設備，生產良率與技術能力同步升級，鞏固高階市場競爭力。憑藉穩定品質、差異化技術與快速協同開發能力，集團於多家記憶體原廠導入次世代產品的開案比重大幅提升，展現核心技術供應商價值。

(3) 各類邏輯 IC 載板(FC CSP、LGA、FBGA/MCP、SiP、LGA 、SILM FCBGA)

Simmtech 集團憑藉在 BT-base 多層薄板製程、mSAP 精密線路、ETS 內埋式結構與 SLIM FCBGA 整合封裝設計四大技術領域的積極佈局，在 AI 與車電應用急速成長的 2024 年，成功取得多家台灣一線 IC 設計大廠專案導入。搭配利機企業在地化服務，進一步強化客戶黏著度與設計贏面(Design-Win Success Rate)。此外，Simmtech 於韓國、日本、中國、馬來西亞所布局之擴產產線，具備跨區調配彈性，可快速因應因貿易戰引發的關稅與地緣政治變化，降低供應鏈風險。

(4) 驅動 IC 相關(IC/Chip Tray、Emboss、Shipping Reel)

利機自行開發的 Reel、Emboss、Chip Tray 除了在地化供應的交貨迅速且有助於客戶端有效降低庫存的優點外，利機長久以來堅持的服務精神與專業的銷售能力，均能在同業的競爭中脫穎而出。利機的產品普遍使用於 tape maker and ILB house，知名度高、品質穩定，頗受好評。

(5) 奈米銀相關產品(Nano Ag related products)

利機銀漿產品最大的優勢在於銀粉自製的能力。根據客戶不同的需求，進行銀粉的開發已滿足客戶的條件。我們現有的產品已達到：

網印銀漿：成功開發 L/S=100/100 um 細線網印銀漿

雷雕銀漿：已滿足目前客戶對於 L/S=30/30 um 之需求，並可適用於多款 ITO film。

異方性導電膠：提供高性能產品以滿足客戶縮小化設計以及生產速率

線寬線距：100/100um；快速固化：3~20 秒

同時，秉持著在地服務的優勢，我們提供客戶快速反應且精確的問題解決能力，加上高品質的產品，使得在客戶端市佔率逐步提升。

利機的核心競爭力是設計和製造自有的奈米銀顆粒。使利機與漢高、賀利氏和 AAM 等主要競爭對手區分開來，並且成為我們獨特的核心競爭力。透過這樣的核心能力，利機開發出目前市場獨有的 175dC 燒結技術並於無壓條件下可支持晶片尺寸至 15*15mm2 的產品，又經深入研究，若採用溫和壓力(1MPa)則可擴大尺寸至 25*25mm2，則可應用於功率模組與散熱器連接。

利機擁有快速應對的研發和業務團隊，能夠對於客戶細部的需求進行一定程度的客製化，進而滿足不同客戶對於燒結銀漿的要求。

5.發展遠景之有利、不利因素與因應對策：

(1)有利因素

發展彈性:處在新趨勢隨時可能顛覆既有產業的時代，通路商反而可以隨著產業需求隨時變換產品線，即時洞察產業趨勢掌握新商機。

企業價值:利機同時位於半導體、光電及綠色能源供應鏈，具備完整的行銷組織，專業化分析未來市場趨勢與規模，因應不同景氣循環，充份發揮交易平台的價值創造全方位的服務品質。

創新能力:以奈米技術為起點，投入新世代材料之開發並厚植製造能力，爭取藍海商機，以落實雙核心競爭力。

集團策略:善用兩岸不同之產業發展歷程與競爭優勢，以集團式發展策略積極開發兩岸三地供應鏈並擴大營運觸角。

(2)不利因素

A.電子產業在 5G、雲端應用、社群網路、物聯網等基礎環境逐漸普及下，變革加速。

因應對策：體認時代趨勢，隨時掌握最新的產業脈動，並善用前述有利因素把握機會並降低風險。

B.川普政府新上任，全球科技廠去中化、美國退出 OECD 全球稅收協議、加重中國關稅課徵等，皆影響全球半導體供應鏈。

因應對策：必須密切關注國際政經局勢變化，靈活彈性布局供應鏈，以應對潛在的風險和機遇。

C.代理產品之代理權有不確定因素。

因應對策：與前幾大供應商透過各種策略，讓雙方不僅是代理權而是更緊密的合作夥伴關係，並分散商品線，逐年擴增新代理產品，分散單一廠商或商品異動的風險。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1.主要產品之重要用途

茲將公司所從事產業之主要產品略述如下：

產業	主要產品	重要用途或功能
半導體產業	封測相關(Capillary、Machine Tool、Lead Frame、Heat Sink)	Capillary(封裝用焊針)及 Machine Tool(封裝用零組件)： 提供客戶 Bonding Capillary , Bonding Wedge , Flip chip Bond Tool 和 Die Bonding Tool 相關的零組件如: 銲針、鋼嘴、頂針、Rubber tip、吸嘴、點膠、畫膠、沾膠耗材及解決方案，並接受客戶委託製作小型陶瓷及其他材料之客戶特殊訂製品。主要使用於封裝製程中之主要設備如:黏晶機/上片機/挑撿機/銲線機/覆晶機之精密零組件，此類設備與材料於半導體封裝、LED 封裝、光電封裝均需使用。

產業	主要產品	重要用途或功能
半導體產業	封測相關(Capillary、Machine Tool、Lead Frame、Heat Sink)	Dual Row QFN Lead frame（雙排無引腳導線架)： 為 IC 晶片訊號傳遞至外界的橋樑，其用途為乘載晶片、訊號傳輸與散熱。 Heat Sink(IC 封裝均熱片)： 晶片運作時產生的熱能透過均熱片快速傳導，以確保 IC 可以持續正常運作。
	各類記憶體 IC 載板（FC BOC、LGA、POP、eMMC/eMCP)	FC-BOC（高階 DRAM 覆晶封裝用基板)：應用於 AI 伺服器、個人電腦及高效能運算平台之 DRAM 模組。 LGA（平面閘格陣列載板)：用於手機與穿戴裝置的多晶片堆疊封裝記憶體模組。 POP（封裝體疊層載板)：智慧型手機、平板與行動裝置使用的記憶體模組。 eMMC/eMCP（嵌入式多媒體載板/多晶片堆疊載板)：智慧型手機與行動裝置搭載之快閃記憶體封裝基板。
	各類邏輯 IC 載板(FC CSP、LGA、FBGA/MCP、SiP、LGA 、SILM FCBGA)	FC CSP（覆晶封裝基板)：適用於智慧型手機、數位視訊、行動裝置等需小型化與高電性表現之 IC 封裝。 LGA（平面閘格陣列載板)：無線電與行動通訊模組，如功率放大器、射頻模組及記憶體堆疊模組。 FBGA/MCP（細間距球型閘格陣列/多晶片堆疊載板)：行動裝置、穿戴設備與消費性電子之快閃記憶體封裝應用。 SiP（系統級封裝載板)：整合異質晶片封裝，適用於電源管理、MEMS、生醫感測、WiFi/Bluetooth 模組等應用。 SILM FCBGA（高階整合式的大尺寸 BT-base 覆晶封裝基板)：應用於 AI 加速器、網通單晶片、PCIe/USB 高速介面 IC、SSD Controller、ADAS 車載晶片等領域。
光電產業	驅動 IC 相關(IC/Chip Tray、Emboss、Shipping Reel)	IC/Chip Tray(晶粒承載盤)：COG 晶粒運送載盤。 Emboss(COF Tape 包裝用間隔帶)： COF tape 運送纏繞用間隔保護帶。 Shipping Reel(COF Tape 包裝用纏繞捲盤)：COF tape 運送用纏繞捲盤。
	OLED 發光材料	OLED 面板的關鍵材料，廣泛應用於手機、Tablet、NB PC、汽車、電視。

產業	主要產品	重要用途或功能
其他產業	奈米銀相關產品 (Nano Ag related products)	Screen Printing Paste(網印銀漿)、 Printing Paste for Laser Etching(雷雕銀漿)：觸控面板的導電線路。 異方性導電膠：提供高性能產品以滿足客戶縮小化設計以及生產速率 Sintering Ag Paste(燒結銀漿)： ①MOSFET(金屬氧化物半導體場效應晶體管) ②PMIC（電源管理集成電路） ③功率模組 屬電路控制和電子設備中的關鍵組件。其中包括白色家電，手持設備，電動汽車，5G 基礎設施和工業控制。 TIM(Thermal Interface Materials)(熱界面材料)：使用於晶片和均熱片之間的導熱(介面)材料，主要應用於 CPU/GPU 設備、無線發射器和汽車電子設備等。

2.產製過程

奈米銀相關產品 (Nano Ag related products)	Ag^{+} + reduction agent + solvent system → Ag^{0} + complicated solvent system

(三)主要原料之供應狀況

產業別	主要產品	主要供應商	供應情形
半導體產業	封測相關 (Capillary、Machine Tool、Lead Frame、Heat Sink)	SPT DNP 明鈞源	良好
	各類記憶體IC載板/各類邏輯IC載板 (FMC、eMMC/eMCP、LGA、POP、BOC、FC CSP、FBGA/MCP、SIP)	Simmtech STG	良好
光電產業	驅動IC相關相關 (IC/Chip Tray、Emboss、Shipping Reel)	勤輝 精材	良好

本公司代理之主要供應商均為世界級大廠，與主要供應商皆維持穩固及良好的合作關係，並簽訂代理契約以確保雙方之權利義務，且本公司所代理之合約，大部份有期滿自動續約之優先條件。

(四)最近二年度任一年度中曾占進（銷）貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進（銷）貨金額與比例，並說明其增減變動原因

1.進貨類：

單位：新台幣仟元

項目	112年度				113年度				114年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至前一季止進貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	勤輝	228,354	32	無	勤輝	278,369	33	無	勤輝	75,299	34	無
2	SPT	237,518	33	無	SPT	196,170	23	無	SPT	48,575	22	無
3	明鈞源	84,220	11	無	明鈞源	114,372	13	無	明鈞源	37,114	17	無
4	DNP	69,975	10	無	DNP	187,789	22	無	DNP	39,862	18	無
5	精材	71,825	10	無	精材	61,360	7	無	精材	13,801	6	無
6	其他	29,355	4	無	其他	18,059	2	無	其他	6,110	3	無
	進貨淨額	721,247	100		進貨淨額	856,119	100		進貨淨額	220,761	100	

變動原因：主要係因產品組合不同之影響。

2.銷貨類：

單位：新台幣仟元

項目	112年度				113年度				114年度截至前一季止			
	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占全年度銷貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係	名稱	金額	占當年度截至一止貨淨額比率〔%〕	與發行人之關係
1	A客戶	293,245	30	無	A客戶	284,056	25	無	A客戶	91,134	30	無
2	B客戶	111,649	12	無	B客戶	132,574	11	無	B客戶	34,514	11	無
3	C客戶	120,304	12	無	C客戶	117,696	10	無	C客戶	24,964	8	無
4	其他	451,199	46	無	其他	619,160	54	無	其他	150,539	51	無
	銷貨淨額	976,397	100		銷貨淨額	1,153,486	100		銷貨淨額	301,151		

變動原因：主要係因產品組合不同之影響。

三、從業員工

最近二年度及截至年報刊印日止，從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率

		112 年度	113 年度	截至 114 年 4 月 30 日
員工人數	業務行銷人員	25	25	25
	行銷支援人員	10	11	10
	研 發 人 員	12	13	13
	行政管理人員	23	23	22
	直接生產人員	0	1	1
	合　　計	70	73	71
平均年歲		42.34	41.9	42.51
平均服務年資		9.38	8.99	9.47
學歷分布比率	博　　士	5.7%	5.5%	5.4%
	碩　　士	32.9%	30.1%	31.2%
	大　　專	60.0%	63.0%	62.0%
	高中 及 以下	1.4%	1.4%	1.4%

四、環保支出資訊

最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所遭受之損失（包括賠償及環境保護稽查結果違反環保法規事項），目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。

五、勞資關係

（一）公司各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與其實施情形，以及勞資間之協議與各項員工權益維護措施情形：

1.員工福利相關措施實施狀況

(1) 薪資結構

依據員工過往經歷、具備能力及應徵職位等因素予以核薪，並優於同業薪資水準。

(2) 獎金制度

整體薪酬優於同業，月薪及年終獎金是基本給與外，結合公司經營績效成果，規劃一系列具激勵工作熱誠的獎金：每年上下半年經營績效獎金、每季業務創利獎金、年度業務成長獎金、新產品獎金、尾牙業績達成獎金、上市櫃公司員工分紅制度及研發專案獎金等等，讓員工能夠與公司共享這份成果。除此，員工的績效與部門績效目標至具80%的連結，以落實獎酬與績效高度連結，每年亦會提撥盈餘配發予員工紅利。各項獎金發放標準如下表：

獎金類別	固定獎金	績效獎金			
	年終獎金	營運獎金	創利獎金	部門成長獎金	新產品獎金
發放對象	全體同仁	全體同仁	業務部門	業務部門	業務部門
發放條件	每年春節發放標準為月薪(扣除伙食費)之二個月	半年稅前每股盈餘達標	業務人均月創利值達標、部門淨利達成率達標	部門淨利年度成長	累計毛利達標
發放時間	每年	每半年	依季別	依年度	次月

(3) 暢通升遷管道

本公司每年舉辦二次晉升作業，提供同仁良好職涯規劃，同時增加員工向心力及企業認同感。

(4) 年度調薪

本公司到職滿一年之員工皆享有年度調薪，除參考物價水準上升率外，亦參加外部薪資比對結果作為調薪的重要參考依據，以確保員工平均薪資所得在市場至少在 PR50 以上水準，目前正積極努力朝向市場 PR75 的水準為目標。

(5) 員工保險

除法定之勞工保險及全民健保，增加投保員工團體保險，包括壽險、意外險、意外醫療險、疾病醫療險及職業災害險等，亦提供眷屬可以優惠保費投保。

(6) 員工健康促進

健康檢查：健康的員工就是公司最棒的財富，由公司專責部門精心規劃半日到院健檢，讓員工掌握自己的健康。另針對高階管理階層施予更進一步健康檢查項目，及製造、研發部門因工作具特殊需求，另增加特殊項目每年檢視，以維護同仁健康及協助同仁掌握自我身體狀況作為飲食選擇及適切運動項目參考。

健康促進活動：每年公司會組織同仁參與外部路跑活動。113 年舉辦健步活動種樹活動，北中南三地同仁包含親屬共同參與，2 個月共累積 2285 萬步，並認養種植 32 顆樹。114 年舉辦檢康減重計畫，為期 3 個月，只要身體年齡低於實際年齡或有進步，或增/減重>3%，即可獲得運動補助。活動最後會將整體減重公斤樹*1,000 元捐作公益，不僅鼓勵員工追求健康生活，也進一步將理念擴及社會弱勢族群。

(7) 全面提昇工作環境至進階版

員工座椅以人體工學椅取代傳統座椅：

112 第二季前全面引進支撐性、舒適度、耐久度更佳的人體工學椅，打造員工輕鬆生活及舒適工作的友善環境，預防員工因久坐不良姿勢所造成的健康問題發生。

定期作業環境監測及作業管理：

111 年 12 月委託外部勞動部認可之作業環境監測機構施予環境監測，以確保所提供的工作場域對同仁是有保障的，日後皆會定期對作業環境監控及作業管理。

(8) 公司旅遊

每年至少補助一萬元以上給予員工舉辦國內或國外旅遊，由同仁自行票選國內外行程，並由專責部門為同仁爭取及規劃 CP 值最佳的行程，參加的眷屬亦享有優惠價。

(9) 家庭日活動

藉由每年舉辦家庭日活動，不僅邀請員工眷屬參加，也開放員工親朋好友一同參與。除增加員工彼此間的感情、對公司的向心力，同時提昇親友對公司的認同度。在 112 年擴大舉行 30 週年慶，精心規劃以鍛鍊員工身心系列活動為主題讓員工及家人一同參加，除運動會外增加路跑活動、玉山登頂及日月潭泳渡等結合健康又極具挑戰自我具有相當意義的活動。113 年家庭日響應 ESG 概念，結合環保與公益主題，將所獲得的政府工作生活平衡補助款與員工紀念品回捐之相對金額，捐作環境公益，參加人數更創下 100 人的紀錄。114 年更首創在樂園舉辦，參加人數突破 130 人，再創新高!

(10) 員工休假

本公司除依照勞動法令給予每週例假及特休假，新人入職 30 天~6 個月，更享優於勞基法特休 3 天特休假，提供優於業界可彈性使用制度，定期提供特休休

假狀況供主管了解及同仁可進行排休，協助同仁達到工作與生活之均衡的幸福企業。

(11)彈性上班

本公司為落實差勤人性化管理，採行彈性上班時間措施，給予同仁些許空間。

(12)各項員工福利津貼及補助

本公司提供同仁婚喪喜慶、急難救助、生日禮金、社團活動補助、及端午、中秋等節慶禮金補助，及不定期公司自製禮品發放。

(13)員工滿意度調查

本公司各項福利活動皆於事後進行滿意度調查，以了解活動內容是否契合員工所需，並根據員工建言進行改善，以使同仁真正達到樂在工作。

2.員工進修、訓練與其實施狀況

(1) 本公司人力精實、工作多樣、分布各地，學習模式以規劃靈活多元為首要，111 年度導入學習平台，以敏捷學習、善用數位工具、整合內外學習資源，提供員工多元、即時、彈性的學習方案，快速提昇職能強化員工素質。

(2) 舉辦內外訓練課程

為配合公司長期發展，並提高從業人員職能素養，本公司依職能及專業之要求，規劃員工相關培訓課程，每年支出教育訓練經費，安排各種管理與技術研發課程，或視需要派員到相關機構受訓或參加中、短期講習，以增進員工知能，提升員工整體之素質，提升經營績效。

(3) 補助員工在職進修

鼓勵員工終身學習，培養與時俱進之技術能力與思維，更精進實戰經驗及拓展人脈，公司對於潛力人才提供優厚學費補助就讀 EMBA、在職專班等進修課程。對於員工進一步就讀博士班，另提供配合課業之彈性上下班考勤方式。

(4) 成立讀書會

本公司編列預算及提供上班時間鼓勵各階層員工參加讀書會，藉由讀書會與他人交流分享，學習更多元的觀點，並養成閱讀的習慣，不斷地增進組織及個人的能力。

(5) 職場進化

除正式訓練，更重視在職訓練與自我學習。強化本職能力，也提升永續競爭力為終極目標。

3.公司工作環境與員工人身安全保護措施

為管理員工健康情況，防止職業病及職業災害發生，確實遵守「勞工安全衛生法」、「勞工健康保護規則」、「勞動基準法」等相關法規施行以下作業，並確實依循以確保工作環境與員工人身安全：

(1) 各辦公處所設置勞工安全衛生管理人員、及防火管理人員。設有消防編組，平時定期進行消防演練及更換過期滅火器材。

(2) 工廠另加設環安衛工程小組，負責廠內安全衛生管理相關作業規劃，包括緊急事故處理與危害預防、防護器具與應變器材之規劃及管理、化學品的儲存記錄及 MSDS 管理和定期巡檢廠區等。

(3) 實施定期健康檢查：本公司提供同仁優於一般勞工健檢之健康檢查，協助員工進行健康管理。對於同仁異常項目，定期提醒同仁追蹤，以確保同仁健康。

(4) 訂定「勞工安全衛生工作守則」，規範勞工安全管理事項。

(5) 備置足夠急救藥品及員工休息室，並配置合格急救人員辦理急救事宜。

除此之外，公司也依據「性別工作平等法」，制定「工作場所性騷擾防治辦法」以及申訴流程; 每年進行性騷擾防治線上宣導。

4、員工行為或倫理守則

本公司編製有工作規則與簽訂勞動契約，以作為員工於服務期間應遵守之各項行為與倫理遵循準繩，員工如有相關行為違反規範時，則視情節輕重提報懲處，並與績效考核制度做連結。其主要內容：

(1) 煽動非法怠工及罷工或聚眾向本公司非法要求、恐嚇勒索者之具體事實者。
(2) 營私舞弊、挪用或虧欠公款、收受賄賂或佣金者。
(3) 有竊盜、賭博、吸毒、對同仁性騷擾或性侵害等行為經查屬實者。
(4) 品行頑劣、行為不良、怠忽職守有具體事實，致本公司蒙受重大損害者。
(5) 利用本公司名義在外招搖撞騙，致使本公司名譽受損失者。
(6) 仿效上級主管人員簽字或盜用印信圖謀不法利益者。
(7) 威脅上級主管人員或撕毀塗改本公司文件者。
(8) 參加經司法機關認定之非法組織者。
(9) 違反聘僱合約書中營業秘密、競業禁止、禁止媒介及智慧財產權相關規定者。
(10)在本公司酗酒滋事妨害工作秩序者。
(11)在外從事與本公司利益衝突之工作，影響勞動契約之履行，情節重大者。
(12) 在工作場所有性侵害或性騷擾、傷風化行為，致本公司形象受損，情節重大者。
(13) 除正當防衛者外，在工作場所毆打他人或互相毆打者。
(14) 在嚴禁吸煙區內吸煙或引火，造成災害者。
(15) 年度內功過相抵仍積滿三大過。
(16) 依照本契約/工作規則調派工作，無故拒絕接受(經勸導無效)並有公然侮辱上級行為有事證者。
(17)侵佔公有財物有事證者。
(18)怠忽工作或貽誤要務，使本公司蒙受損失者。
(19)洩漏業務機密，使本公司蒙受損失者。
(20)託人或替人代刷卡(打卡)，經查證屬實且屬再犯者。
(21)偷竊同仁或公司財物或產品有事證者。
(22)偽造、變造或盜用本公司印信，圖謀不軌，有事證者。
(23)張貼、散發煽動性文字、圖書足資破壞勞資情感，情節重大者。
(24)對同仁暴力威脅、恐嚇，致妨害生產工作蒙受嚴重損失者。
(25)聚眾要挾，妨害生產秩序之進行者。
(26)擅離職守，導致本公司發生重大災變，使本公司蒙受重大損害者。
(27) 攜帶違反政府法令嚴禁物品(如刀槍、彈藥、爆炸物等)危害本公司財產或員工生命安全者，或是在禁煙地區抽煙或引火者。
(28)同時與他人建立勞動關係，經查證屬實者。

5.退休制度與其實施狀況

(1) 自九十四年七月一日起，為新進及選擇適用勞工退休金條例之退保金制度之員工，按其每月薪資 6%提撥至勞工保險局之個人退休金專戶。
(2) 員工選擇適用退休金舊制辦法，及選擇退休金新制但保有舊制年資者，依其每月薪資 2%提撥勞工退休準備金，儲存於中央信託局退休準備金專戶中，以保障員工生活。
(3) 每年由精算師精算員工退休準備金是否足額提撥及適當提撥率規劃，悉依精算結果補充提撥。
(4) 本公司訂有員工退休辦法，並已成立退休準備金監督委員會，有關員工退休之條件悉依勞基法第 53 條及第 54 條規定，其程序如下：

A. 申請退休

自請退休之員工應填具申請退休表，強制退休者則由人力資源單位填具退休表。

B. 退休審核

經所屬各級主管與行政部審核後，呈總經理／董事長核准之。

C. 退休手續

退休之員工於離職前，須按照人員離職手續辦理離職，完成各項交接手續，由直接主管督導完成該員工作以及財務，物品之移交，並償還各項借支。

D. 退休金核發

員工退休金之核發於退休生效之日起算一個月內發放。

(5) 有鑑於資深員工對公司長期累積的貢獻與穩定投入，114 年更優於勞動基準法退休金制度，提前讓資深員工結清舊制年資，領回舊制退休金或投入新制退休金帳戶，讓員工可以有更靈活彈性的資金運用，也表達公司對資深員工的肯定。

6. 勞資間之協議情形

本公司各項制度運作健全，勞資關係一向和諧，未曾產生任何勞資糾紛，故亦無勞資間之協議情形發生。

7. 各項員工權益維護措施情形

本公司屬勞基法適用行業，一切運作均以勞基法為遵循基準，本公司為促進勞資合作，提升工作效率，依據勞資會議實施辦法，定期召開勞資會議，藉以勞資雙方溝通意見，相互合作。

（二）最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失(包括勞工檢查結果違反勞動基準法事項，目前及未來可能發生之估計金額與因應措施:

本公司自成立至今，勞資關係和諧，並無發生因勞資糾紛而導致損失之情事，預估未來因勞資糾紛而導致損失的可能性極其低微。

六、資通安全管理

（一）資通安全風險管理架構、資通安全政策、具體管理方案及投入資通安全管理之資源

1. 資通安全風險管理架構

(1) 本公司成立資通安全小組，落實資通安全管理，成員包含資訊安全主管、資安專責人員、資訊組工程人員、稽核組稽核人員，負責督導、維運與稽核，資安管理事項請參閱下列 6 項說明。

(2)資通安全小組執行事項:

1)資通安全規範建立與督導。

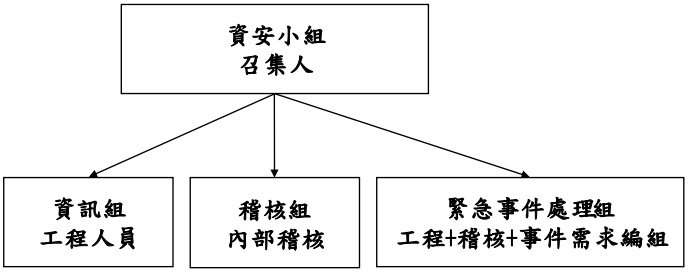
2)資通安全作業執行與協調。

3)資安緊急事件處置與監督。

4)資通安全事件檢討與改善。

5)相關資訊安全事項執行與稽核。

6)定期召開資訊安全會議。



召　集　人　：資訊安全主管
工 程 人 員 ：資安專責人員及資訊部門成員
內 部 稽 核 ：由公司稽核人員組成
事件需求編組: 依事件需要進行臨時編組

(3)本公司稽核組為資訊安全監理之查核單位，若查核發現缺失，隨即要求受查單位提出相關改善計畫並呈報董事會，且定期追蹤改善成效，以降低內部資安風險。

(4)資訊安全工作-採 PDCA（Plan-Do-Check-Act）循環式管理，確保可靠度目標之達成且持續改善。

2.資通安全政策

為確保本公司資通訊作業安全與穩定之運作，提供可信賴之資通訊服務，並順利推展本公司各項業務，符合資通安全管理作業，本公司資通安全政策將落實下列政策原則。

(1)兼顧資訊安全與便利使用。

(2)避免內外部的資安風險。

(3)確保服務穩定可用。

(4)達成企業永續經營。

3.具體管理方案

因應近年資安事件頻傳，本公司針對各項資訊系統與規則強化管理機制，具體方案如下:

(1)制定使用者設備的使用規則,區隔並限制私人設備與公司設備的使用環境與上網權限，嚴禁非允許設備使用內部網路，並針對隨身碟等外部儲存裝置需經過檢測方可於公司電腦使用。

(2)個人電腦與資訊主機定期執行病毒掃描，安全性更新，並每年針對公司重大資訊系統執行弱點掃瞄，修補安全漏洞。

(3)強化資料備份頻率與異地資料保存。

(4)加強員工資安觀念，定期透過會議、公告、企業內部網站等，向同仁宣導資安觀念與個案分享，如有可疑之資料及電子郵件請勿輕易開啟，避免遭到社交工程攻擊。

(5)加入資安聯防組織與定期參與資安相關研討會,透過資安訊息分享隨時提升資安資訊與防護知識，避免訊息孤島，衍生防護漏洞。

4.投入資通安全管理之資源

本公司持續投入資訊安全與資料保護，個資保護等相關作業，資源投入事項包含完善治理面及技術面之安全基礎架構、強化資安防禦設備、與教育訓練等，每年檢討公司資安防護狀況，適時更新資安防護設備，防護效果最佳化。

5.113 年資安推行成果:

(1)資訊系統災難復原模擬演練，每年 1 次演練，完成率 100%。

(2)每季資安宣導暨重要資安宣導，每年 4 次，完成率 100%。

(3)資安同仁參與資安相關研討會或訓練，每年二次，完成率 100%。

(4)委外廠商進行主機弱點掃描與修補，完成率 100%。
(5)委外廠商實施社交工程暨資安防護演練，完成率 100%。

（二）最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施:無此情形。

七、重要契約

列示截至年報刊印日止，仍有效存續及最近年度到期之供銷契約、技術合作契約、工程契約、長期借款契約及其他足以影響股東權益之重要契約之當事人、主要內容、限制條款及契約起訖日期。

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
代理銷售契約	Hitachi Cable, Ltd.	1995.10.1 起雙方無異議時持續有效	Lead Frame TAB Tape for BGA TCP/COF Tape	代理地區：台灣及中國特定地區
代理銷售契約	Hitachi Cable Asia Ltd. (Philippine Branch)	2006.8.25-2007.8.25 雙方無異議時持續有效	Lead Frame Products	代理地區：台灣
代理銷售契約	SPT ASIA PTE. LTD.	2008.10.1 起雙方無異議時持續有效	Wire Bonding Capillary／Die Attachment Tools／Bonding Wedge	代理地區：台灣
代理銷售契約	勤輝科技(股)公司	2019.01.1-2021.12.31 止，雙方無異議時持續有效	CHIP TRAY /Reel/FMC Lid	代理地區：台灣
代理銷售契約	精材實業(股)公司	2019.01.1-2021.12.31 止，雙方無異議時持續有效	Emboss Tape	代理地區：台灣
代理銷售合約	DNP Taiwan Co., Ltd.	2005.5.1 起雙方無異議時持續有效	Metal Masks Lead Frames Substrates	代理地區：台灣
代理銷售合約	SOLVAY FLUOR KOREA	2009.9.1 起雙方無異議時持續有效	Specialty Gas	代理地區：中國
代理銷售合約	Shinryo Corporation	2007.09.1 起雙方無異議時持續有效	Reclaim Wafer	代理地區：中國
代理銷售合約	Hitachi Cable Asia Pacific (HCAP) PTE ,Ltd.	2010.11.1 起雙方無異議時持續有效	Lead Frame	代理地區：台灣
代理銷售合約	SIMMTECH CO., LTD	2025.3.1-2025.12.31 雙方無異議時持續有效	Substrates	代理地區：台灣
代理銷售合約	Eastern Co., Ltd.(STG)	2018.11.1-2020.12.31 期滿每年持續自動延長	Substrates	代理地區：台灣
代理銷售合約	鎧世通科技有限公司	2024.01.01-2024.12.31 期滿每年持續自動延長	平面顯示器相關材料	代理地區：中國
代理銷售合約	GHM Co., Ltd. Truly Co., Ltd.	2021.02.18-2024.02.1 期滿每年持續自動延長	Tapes	代理地區：台灣及中國

契約性質	當事人	契約起迄日期	主要內容	限制條款
代理銷售合約	錦立工業有限公司	2023.11/01-2025.10.31 期滿每年持續自動延長	半導體製程設備真空角閥及相關真空零部件	代理地區：台灣及中國
代理銷售合約	蘇州賽爾科技有限公司	2023.08.01-2026.07.31 期滿每年持續自動延長	半導體晶圓減薄輪、磨頭及封裝切割相關刀具等零部件	代理地區：台灣
代理銷售合約	SIMMTECH INTERNATIONAL PTE. LTD.	2025.3.1-2025.12.31 雙方無異議時持續有效	Substrates	代理地區：台灣
代理銷售合約	巨貿精密工業股份有限公司	2024.05.01-2027.04.30 期滿每年持續自動延長	燒結銀漿相關產品	代理地區：中國
代理銷售合約	VacuumALL Co., Ltd	2023.09.01-2026.08.31 期滿每年持續自動延長	真空隔離閥相關產品 Vacuum Isolation Valves related products	代理地區：台灣及中國
代理銷售合約	NOVASEN Co., Ltd	2023.04.01-2025.03.31 期滿每年持續自動延長	真空控制閥相關產品 Vacuum Control Valves related products	代理地區：台灣及中國

伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項

一、財務狀況

單位：新台幣仟元

年度 項目	113 年度	112 年度	差異	
			金額	%
流動資產	951,281	918,214	33,067	3.60
透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動	57,076	64,603	(7,527)	(11.65)
採用權益法之投資	195,834	198,831	(2,997)	(1.51)
不動產、廠房及設備	286,419	223,341	63,078	28.24
無形資產	102	623	(521)	(83.63)
其他資產	21,794	24,688	(2,894)	(11.72)
資產總額	1,512,506	1,430,300	82,206	5.75
流動負債	405,531	314,270	91,261	29.04
非流動負債	32,690	29,561	3,129	10.58
負債總額	438,221	343,831	94,390	27.45
歸屬於母公司業主之權益	1,074,285	1,086,469	(12,184)	(1.12)
股本	449,969	441,146	8,823	2.00
資本公積	261,106	261,106	0	0.00
保留盈餘	387,038	394,683	(7,645)	(1.94)
其他權益	(23,828)	(10,466)	(13,362)	127.67
非控制權益	0	0	0	0.00
權益總額	1,074,285	1,086,469	(12,184)	(1.12)

變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元之分析說明：

1. 不動產、廠房及設備: 主要係本期增加購置企業總部之未完工程，致不動產、廠房及設備增加所致。
2. 流動負債: 主要係本期應付帳款增加，致流動負債增加所致。
3. 負債總額: 主要係本期應付帳款增加，致流動負債及負債總額增加所致。
4. 其他權益: 主要係本期轉投資公司依公允價值認列其評價，使其認列評價減少所致。

二、財務績效

（一）最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因

單位：新台幣仟元

項目	113 年度	112 年度	增（減）金額	變動比例%
營業收入淨額	1,153,486	976,397	177,089	18.14
營業成本	868,560	720,641	147,919	20.53
營業毛利	284,926	255,756	29,170	11.41
營業費用	206,633	180,477	26,156	14.49
營業淨利	78,293	75,279	3,014	4.00
營業外收入及支出	65,185	36,565	28,620	78.27
稅前淨利	143,478	111,844	31,634	28.28
所得稅費用	36,026	18,299	17,727	96.87

項目	113 年度	112 年度	增（減）金額	變動比例%
本年度淨利	107,452	93,545	13,907	14.87
變動比例達百分之二十以上，且變動金額達新台幣一仟萬元之分析說明： 1. 營業成本增加：主要係本期銷貨收入增加，致營業成本上升所致。 2. 營業外收入及支出增加:主要係加值型轉投資公司獲利增加及匯兌收益增加所致。 3. 稅前淨利增加:主要係受營業外收支之兌換利益及投資利益增加所致。 4. 所得稅費用增加：主要係認列加值型轉投資盈餘匯回之所得稅費用所致。				

（二）預期未來一年度銷售數量及其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫：請參閱本年報第3頁一一三年營業計劃概要內容說明。

三、現金流量

(一)最近年度現金流量變動之分析說明：

	113 年 12 月 31 日	112 年 12 月 31 日	增(減）比率
現金流量比率（%）	21.82%	50.49%	(56.79)%
現金流量允當比率（%）	103.72%	113.69%	(8.77)%
現金再投資比率（%）	(1.12)%	(0.76)%	46.42%
現金流量比率減少：係本期因應付帳款增加，使流動負債增加，致現金流量比率下降。 現金再投資比率減少：受營業活動所產生的現金流量流出及發放現金股利影響所致。			

(二)流動性不足之改善計畫：無此情形。

(三)未來一年現金流動性分析：

單位：新台幣仟元

期初現金餘額	全年來自營業活動淨現金流量	全年現金流入(出)量	現金剩餘(不足)數額	現金不足額之補救措施	
				投資計畫	理財計畫
333,159	(6,349)	59,782	386,592	-	-

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

1. 本公司因營運發展用途於 113 年 3 月經董事會決議通過購置企業營運總部，合約總價款 371,580 仟元，已依付款進度於 113 年 12 月 31 日帳入未完工程 65,885 仟元。
2. 此為預售屋，各期款與預計付款期間：

項目	金額	預計付款
15%訂簽開	55,730,000	2024/3
15%工程款	55,760,000	2024~2027
65%交屋款	241,520,000	2028Q1交屋
5%保留款	18,570,000	2028Q1
合計	371,580,000	

2. 擬以利機企業自有資金支應，四年後若營運資金不足可融資或作為擔保借款之抵押品，資金來源無虞。
3. 以銀行融資支應試算 2028 年負債比約 35%，財務結構穩健。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫

單位:新台幣仟元

轉投資事項	原始投資	政策	獲利或虧損之主要原因	改善計畫	未來其他投資計畫
Advanced 公司	45,496	投資控股	尚屬良好	不適用	視營運狀況而定
STNC 公司	44,506	佈局未來中國地區之業務擴展	獲利情形尚屬良好		
利騰公司	52,621	多角化經營	獲利情形尚屬良好		因應利騰母公司調整全球策略布局，本公司預計出售 527,400 股。
APET 公司	20,362	擴大產品線及穩固代理權	尚屬良好		視營運狀況而定
精材公司	3,359	看好 Emboss Tape 市場發展潛力	獲利情形尚屬良好		
GST 公司	11,669	佈局未來中國及日本地區之業務擴展	尚屬良好		
強芳公司	4,350	代工業務不致被壟斷及成本考量	設立初期技術研發中	技術已獲認證，待客戶下單	
耀儒公司	27,200	擴展半導體前段特氣等產品線	營收規模尚不足以支應費用，持續虧損中	持續監控營運風險	

六、最近年度及截至年報刊印日止之風險事項

(一)利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施

1.對公司損益之影響

(1)利率：

科目	113 年度(仟元)	佔銷貨淨額
利息收入	6,097	0.53%
利息費用	523	0.05%

113年底無借款。目前央行政策為物價與金融穩定，並促進經濟成長，維持穩定之利率，且本公司具現金流入快速之特性，還款速度快，因此利率變動對損益將不會有重大影響。

(2)匯率：

科目	113 年度(仟元)	佔銷貨淨額
兌換利益	20,804	1.80%

本公司銷貨中約有54%-59%而成本中約有45%-46%，主要受到匯率波動之影響。當新台幣相對於美元變動5%時，將使稅前淨利變動之金額。

	113年度(仟元)
美　　金	$ 19,711

(1) 通貨膨脹：

本公司隨時注意市場價格之波動，若通貨膨脹1%，將增加本公司費用支出約新台幣2,066仟元。

2.未來因應措施

(1)利率：

本公司與往來銀行保有相當良好之授信關係，並備置足額之融資額度。本公司之利率變動風險主要來自各項長、短期負債，本公司借款主係供營運週轉及避險使用，除密切觀察資本市場變化，並且定期蒐集利率變動資訊，以適時採取適當之因應措施來降低利率風險。

(2)匯率：

本公司銷售之各項產品大部分屬代理國外之電子零件及設備，再銷售予國內廠商，因此匯率變動對本公司有存在之風險，公司目前所採取之方案如下：

1)原則上對於主要之進、銷貨採取原幣別收付方式，藉由經常性進、銷帳目相互沖抵，以達到自然避險效果。

2)經辦人員隨時蒐集有關匯率變化資訊，充分掌握匯率走勢，決定兌換幣別以降低營業風險。

3)善用國內外匯兌避險操作，以規避匯率波動所造成之風險。

(3)通貨膨脹：

本公司隨時注意市場價格之波動，並與供應商及客戶保持良好互動關係。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

1.最近年度從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人及背書保證

本公司依「資金貸與他人及背書保證處理程序」辦理。截至年報刊印日無資金貸與他人及背書保證情事。

2.本公司基於避險之考量必要時以訂定遠期外匯合約之方式降低外幣交易之匯率波動風險。

(三)未來研發計畫及預計投入之研發費用：

研發計劃請詳第 49 頁營業概況之（三）技術及研發概況。114 年度預計投入之研發費用為 39,495 仟元。

(四)國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施

本公司管理階層將隨時注意國內外重要政策及法律變動並適時提出因應措施。

(五)科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施

本公司隨時注意半導體、光電產業及綠能產業之技術發展演變，並著手評估及研發以符合市場潮流，最近年度因 COVID-19 疫情影響，催生遠距辦公及宅經濟商機，且 5G 產業正式邁入量產階段，對公司所處之半導體及光電等產業影響深遠也擴大商機，雖然也挑戰供應鍊的穩定性，對公司財務業務仍屬有利發展。

針對資訊安全面，公司建構完整的網路與電腦系統管理機制以符合利害關係人與相關法規之要求，並每年配合稽核機構的風險評鑑與定期資安風險評估，透過系統升級與資安強化，有效維持公司資訊安全與長期競爭力之目的。

近年資安事件頻傳，除上述制度與措施外，並增加每年委外專業廠商進行系統漏洞偵測與防護補強措施，搭配不定期資安宣導，建構多層嚴密防護機制，實施嚴

格資安控管。截至年報刊印日止，本公司並無科技改變（包括資通安全風險）對公司財務業務造成影響。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施

本公司自創立以來，即積極強化公司內部管理及塑造公司核心價值，企業形象良好，迄今尚無因企業形象而造成企業危機之情事。未來本公司將恪遵公司治理之各項要求，以降低企業形象改變而造成企業危機。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施

本公司最近年度及截至年報刊印日止並無從事併購，未來若從事前述相關計畫之評估及執行時，亦將依本公司相關規定及相關法令規範辦理。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施

本公司廠房之擴充與增建，皆有經相關技術團隊及公司規範進行可行性評估及財務分析以掌握其可能風險，並備妥相關因應措施。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施

1.進貨

本公司所代理之合約，大部分為期滿自動續約之優先條件，且所代理產品均為技術層次較高之產業，供應商與客戶對本公司之依存度高，競爭對手切入不易，前十名廠商中有 SPT、勤輝、明鈞源及 DNP 所佔進貨比率超過 10%，其餘廠商之進貨比率皆於 10%以下。另公司亦逐年擴增新產品代理，使公司業績來源分散，不會因其中一兩個產品線不順利而影響公司成長，預期無重大風險。

本公司所代理 SPT 之 Capillary 產品，為世界一級生產製造商，可提供少量多樣、客制化需求的服務能力，滿足百家以上客戶 Just-in-time 即時服務的需求，本公司因其高專業度可更有效率地幫助客戶取得適合之 Capillary 工具。

另為擴展 Emboss Tape 市場轉投資供應商之一勤輝科技所創設之精材實業股份有限公司約 12%股權，強化與勤輝科技之合作關係。

2.銷貨

最近二年度，主要客戶僅有三家達公司全年度營收淨額之 10%，銷貨仍屬相當分散，故本公司尚無銷貨集中所面臨之風險。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施

本公司董事或持股超過百分之十之大股東，最近年度及截至年報刊印日止並無股權大量移轉之情事，公司之經營權穩定。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施

本公司營運穩健，獲利良好，董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，最近年度及截至年報刊印日止並無股權大量移轉之情勢，公司之經營權穩定。

(十二)訴訟或非訟事件：無。

(十三)其他重要風險及因應措施：無。

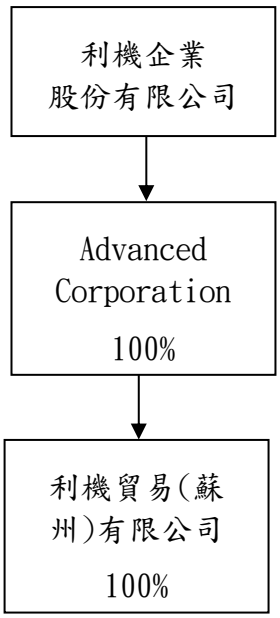
七、 其它重要事項：無。

陸、 特別記載事項

一、 關係企業相關資料

（一）關係企業合併營業報告書

1.關係企業組織圖



2.各關係企業基本資料

單位：仟元

企業名稱	設立日期	地　址	實收資本額	主要營業項目
Advanced Corporation	2001/08/02 (90/08/02)	Offshore Chambers.P.O.Box 217,Apia,Samoa.	NT 57,948 (US 1,800)	一般投資業及進出口貿易
利機貿易(蘇州)有限公司	2002/01/30 (91/01/30)	蘇州工業園區星漢街5號C幢1F 03/04單元	NT 64,492 (US 2,100)	半導體、光電、電子與機械等產品製造所需的設備、材料及零配件的批發、進出口、佣金代理（拍賣除外）及相關配套業務。

3.整體關係企業營運

(1)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：整體關係企業主要經營半導體、光電及綠能通路。

(2)各關係企業間所經營業務互有關聯者，應說明其往來分工情形：本公司與各關係企業間產品之銷售，為有效率就近提供客戶服務亦有相互支援服務，並依其毛利金額計收佣金。

4.各關係企業董事、監察人與總經理資料

單位：仟股；%

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
Advanced Corporation	董事	利機企業股份有限公司	1,800	100%
利機貿易(蘇州)有限公司	董事長	張宏基	—	100%
	董事	張濬暉		
	董事/總經理	黃道景		
	監察人	邱智芳		

5.各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業利益	本期稅後損益	每股稅後盈餘
Advanced Corporation	57,948	48,400	621	47,779	180	(2,914)	646	N/A
利機貿易(蘇州)有限公司	64,492	34,427	4,392	30,035	20,929	(59)	2,94	N/A

註：N/A:係為有限公司，無計算每股盈餘問題

（二）關係企業合併財務報表：

本公司民國 113 年度（自民國 113 年 1 月 1 日至 12 月 31 日止）依「關係企業合併營業報告書、關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依國際財務報導準則第 10 號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

（三）關係報告書：無。

二、 最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。

三、 其他必要補充說明事項：無。

柒、最近年度及截至年報刊印日止，如發生本法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。

利機企業股份有限公司

負責人：張濬暉